下载日志已记录，仅供内部参考

行业研究

行业深度报告

开源证券 证券研究报告

电子

2026 年 08 月 24 日

投资评级：看好（维持）

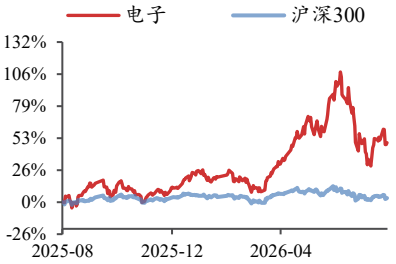
去日化材料破局 | 湿电子化学品：需求扩容+工艺升级+国产替代，步入量价齐升快车道

——行业深度报告

陈蓉芳（分析师）
chenrongfang@kysec.cn
证书编号：S0790524120002

祁海超（联系人）
qihaichao@kysec.cn
证书编号：S0790125070022

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《长存控股发布招股书，台积电完成 1.6nm 工艺开发—行业周报》-2026.8.23

《Fab 厂业绩超预期，联想 AI 业务显著增长—行业周报》-2026.8.16

《电子板块集体反弹，海外科技龙头交出亮眼财报表现—行业周报》-2026.8.9

● **制造端景气高企，半导体材料行业再迎上行周期**

AI 时代半导体材料市场迎来新一轮发展良机。AI 带动先进计算/存储等行业需求释放，半导体制造端稼动率高企，扩产进入上行周期。半导体材料作为行业最上游，在本轮成长周期中亦景气高企。全球半导体材料市场规模由 2023 年的 650 亿美元增长至 2025 年的 732 亿美元，晶圆制造材料市场规模由 415 亿美元提升至 458 亿美元，预计 2026 年进一步增至 489 亿美元。2026 年 Q1 全球硅片出货量同比增长 13%，已经是连续第 7 个季度出货量同比增长。我们认为，随晶圆制造厂投片量持续上行，半导体材料行业有望持续受益。

● **湿电子化学品：扩容叠加工艺升级，行业进入量价齐升的发展快车道**

湿电子化学品按用途分为通用型和功能型；按场景分为集成电路、显示面板及光伏等，光伏凭借庞大产能贡献主要需求量，而集成电路占据约 70%的全球市场规模，主因高等级产品对纯度、洁净度和稳定性要求更为严格，具有更高价值量。**集成电路领域：工艺升级带动单位材料消耗提高+产品高端化。**除制造端扩产直接带动需求扩容外，更关键的是，新增晶圆制造产能多集中于先进制程以及 3D NAND 等高端芯片领域，图形化工艺步骤相应增加，进而带动配套的清洗、刻蚀、CMP 等工艺环节，提高平均单位材料消耗。同时产品高端化带动价格提升。**显示面板及光伏领域：**显示面板领域行业稼动率修复及下游需求回暖带动是湿电子化学品需求稳步提升。光伏领域，虽然湿电子化学品纯度等指标要求较低，但由于光伏电池片出货量大、工艺步骤重复性强，整体用量具备较强规模效应。

● **日系及欧美厂商把控核心品类，“去日化”预期加速国产厂商破局**

海外厂商占据高端环节：日本及欧美企业在全球集成电路用湿电子化学品市场份额分别约为 27%和 30%。**日系材料集群优势明显：**在高纯氟化物、超纯清洗材料、CMP 材料等领域积累深厚，光刻所需化学品及配套材料亦是其强势领域。**受地缘政治博弈影响，上游关键材料的供应链风险被推至前所未有的高度。“去日化”避险情绪升温，或促使国内主流晶圆厂及封装厂大幅加快本土供应商的验证与提量进程。本土湿电子化学品厂商加速迈入“全面替代”的黄金窗口期。**

● **国产替代稳步推进，看好平台型厂商与细分领域龙头**

我们认为，国产替代正逐步由通用产品向高端材料深化，在当前关键窗口期，稳定供应能力或决定中期市场份额。看好材料平台型厂商+细分领域领先玩家。**受益标的：安集科技、鼎龙股份、兴福电子、上海新阳、中巨芯-U、翰博高新、新化股份、阿拉丁、格林达等。**

● **风险提示：**产业景气不及预期，国产替代不及预期；原材料价格波动风险等。

下载日志已记录，仅供内部参考

目　录

1、 半导体景气上行，材料需求同步释放 5
1.1、 AI 算力时代，半导体材料步入新一轮上行周期 5
1.2、 半导体材料市场规模再创新高，湿化学品市场增速突出 6
1.2.1、 工艺流程：材料是支撑制造与封装工艺的关键基础 6
1.2.2、 市场规模：半导体景气上行带动全球材料市场销售额新高 6
1.2.3、 湿化学品：贯穿制造流程，市场增速突出 7
2、 需求扩容+国产替代，湿电子化学品步入发展快车道 9
2.1、 应用场景：集成电路、面板与光伏协同驱动湿化学品需求增长 9
2.2、 集成电路：扩产周期与工艺升级驱动，湿电子化学品量价齐升 11
2.2.1、 逻辑芯片：制程升级，图案化步骤增加带动需求提升 12
2.2.2、 存储芯片：3D 化与堆叠层数倍增，拉动湿化学品需求提升 14
2.2.3、 先进封装：后摩尔时代技术创新，材料需求持续释放 16
2.3、 显示面板：面板制造需求增长，湿化学品用量稳步提升 17
2.4、 太阳能光伏：电池片产能规模庞大，湿化学品需求维持高位 19
2.5、 供给格局：日系欧美厂商把控核心品类，国内厂商加速破局 20
3、 行业多点开花，优质厂商迎发展机遇 24
3.1、 安集科技：CMP 材料领军者，功能性湿化学品加速拓展 24
3.2、 鼎龙股份：半导体材料多点布局，抛光液/清洗液优势强 25
3.3、 兴福电子：高纯电子化学品平台型企业，电子级磷酸优势突出 25
3.4、 上海新阳：电子级电镀材料龙头，产能快速扩张 26
3.5、 中巨芯-U：高纯湿化学品优势突出，功能性配方加速拓展 27
3.6、 翰博高新：外延切入湿化学品，打开材料业务第二增长曲线 28
3.7、 新化股份：传统化工底盘扎实，电子级化学品业务持续推进 29
3.8、 阿拉丁：科研试剂基础深厚，积极布局电子级材料领域 31
3.9、 格林达：TMAH 显影液优势突出，集成电路客户导入持续推进 31
4、 风险提示 33

图表目录

图 1： 全球硅片出货量连续修复，半导体材料需求进入上行阶段 5
图 2： 半导体制造环节涉及多种不同材料 6
图 3： 全球半导体材料规模持续上行（亿美元） 7
图 4： 硅片仍为最大晶圆制造材料，湿化学品与 CMP 占据重要份额（亿美元） 7
图 5： 中国大陆已成为全球第二大半导体材料市场 7
图 6： 2025 年中国大陆半导体材料市场增速领先大部分主要地区 7
图 7： 2026 年湿化学品与 CMP 材料增速预计领先晶圆制造材料大盘 8
图 8： 湿电子化学品占据重要份额 8
图 9： 含泛湿电子化学品的市场规模稳步提升（亿美元） 8
图 10： 湿电子化学品上下游产业链 9
图 11： 集成电路用湿化学品市场规模较大（2024 年） 10
图 12： 湿电子化学品三大应用场景需求量（万吨） 10
图 13： 湿电子化学品在集成电路制造中的应用 11
图 14： 中国集成电路用湿化学品市场稳步增长，前道制造贡献主要需求（亿元） 11

下载日志已记录，仅供内部参考

图 15：2023 年全球集成电路用湿电子化学品细分占比 12
图 16：2023 年湿电子化学品领域：欧美、日本、中国台湾仍占据全球主要份额，分别约为 30%、27%和 18% 12
图 17：逻辑芯片制程升级驱动晶圆刻蚀次数上升 12
图 18：成熟与先进逻辑晶圆需求均有望持续增长（百万片/月） 12
图 19：逻辑芯片技术路线图：更复杂工艺对于湿化学品有更高要求 13
图 20：2026 年头部晶圆厂继续加码先进制造资本开支（亿美元） 13
图 21：全球 DRAM 和 NAND 季度市场规模（亿美元） 14
图 22：DRAM 晶圆需求增速预计快于 NAND（百万片/月） 14
图 23：DRAM 技术路线愈加复杂，湿化学品需配套升级 15
图 24：3D NAND 技术路线图：堆叠层数持续增加，单位材料需求增长 15
图 25：NAND 层数提升显著增加台阶与清洗工艺次数 16
图 26：3D NAND 堆叠层数加速迈向 300 层以上 16
图 27：逻辑芯片制程升级与 3D NAND 层数提升都将带动单位晶圆消耗材料提升 16
图 28：高端封装出货量预计 2023—2029 年增长约 10 倍（百万颗） 17
图 29：先进封装环节湿电子化学品的应用 17
图 30：湿电子化学品用于光伏电池片制造的清洗/蚀刻过程 18
图 31：中国显示面板用湿电子化学品需求量有望稳步提升（单位：万吨） 18
图 32：OLED 需求量和市场规模增长快于 TFT-LCD（需求量单位：万吨；市场规模单位：亿元） 19
图 33：湿化学品用于电池片制造的制绒/清洗/蚀刻过程 20
图 34：制绒是通过化学腐蚀在硅表面形成绒面结构 20
图 35：全球光伏新增装机增长支撑湿化学品高位需求（GW） 20
图 36：安集科技主要产品在芯片制造及先进封装领域的应用 24
图 37：安集科技 2025 年营收利润高增，功能性湿化学品加速放量（百万元） 24
图 38：CMP 工艺原理图 24
图 39：鼎龙股份主要产品及应用 25
图 40：鼎龙股份 2025 年利润增速显著快于收入，2026Q1 弹性延续（百万元） 25
图 41：兴福电子主要产品在芯片制造中的应用 26
图 42：兴福电子 2025—2026Q1 收入利润保持较快增长（百万元） 26
图 43：上海新阳近年来积极扩建项目 27
图 44：上海新阳 2025 年利润增速快于收入，2026Q1 延续高弹性（百万元） 27
图 45：中巨芯-U 2026H1 收入平稳推进，归母净利润增速快于收入（单位：百万元） 28
图 46：翰博高新主要产品在液晶显示面板中的构成情况 29
图 47：翰博高新 2026Q1 实现单季度扭亏（百万元） 29
图 48：新化股份收入短期平稳（百万元） 29
图 49：阿拉丁部分用于半导体和微电子的实验室试剂产品 31
图 50：阿拉丁收入增长较快，但利润弹性仍待释放（百万元） 31
图 51：格林达主要产品应用领域及工艺环节介绍 32
图 52：格林达 2025—2026Q1 收入利润短期承压（百万元） 32

表 1：湿电子化学品种类丰富 10
表 2：不同应用领域湿电子化学品等级要求不同 11
表 3：TFT-LCD 与 OLED 不同维度的对比 19
表 4：欧美主要湿化学品厂商聚焦高端品类 21
表 5：日本主要湿化学品产商：功能性湿化学品形成较强产品集群 21
表 6：国内主要湿化学品厂商：多点开花，积极拓展高端领域 22

下载日志已记录，仅供内部参考

表 7： 中巨芯-U 主要电子湿化学品产品 27
表 8： 新化股份主要产品 30

下载日志已记录，仅供内部参考

1、 半导体景气上行，材料需求同步释放

1.1、 AI 算力时代，半导体材料步入新一轮上行周期

半导体材料需求随制造周期波动，硅片出货量与行业景气高度相关，作为高频数据具有较高参考价值。半导体材料作为晶圆制造和封装测试过程中的关键消耗品，其需求与下游晶圆厂开工率、投片量和制程复杂度密切相关。硅片是晶圆制造的基础载体，其他材料虽品种众多，但考虑数据可得性，硅片出货量变化是能较好反映制造端真实需求的高频指标。2018 年以来，费城半导体指数与全球硅片出货量在多个周期阶段呈现同向变化，指数端通常率先反映市场预期，硅片出货量随后体现晶圆厂订单、开工率和投片需求的变化。分阶段看：

2018-2019 年，受存储价格下行、智能手机需求放缓及行业去库存影响，半导体景气度回落，费城半导体指数承压，全球硅片出货量同步下行。

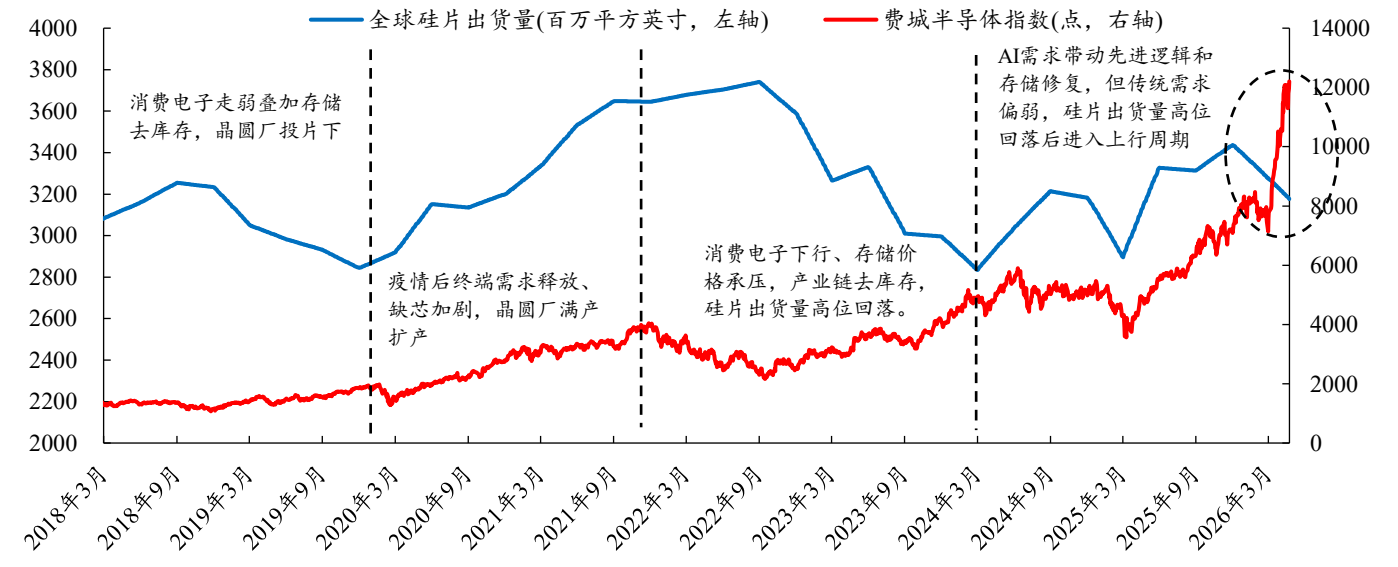
2020-2021 年，疫情后居家办公、数据中心、消费电子及汽车电子需求共振，供给侧晶圆产能趋紧，行业进入上行周期，积压需求释放带动行业创阶段高点，半导体指数同步走强，硅片出货量持续修复。

2022 年至 2023 年，行业进入主动去库存阶段，晶圆厂通过降低投片量、压缩采购来应对需求走弱。指数进入调整期，硅片出货量明显下滑。

2024 年以来，AI 算力、先进存储需求释放，存储价格修复，行业预期改善，半导体指数率先上行。自 2024 年 Q3 硅片出货量开始同比提升，AI 时代逐步到来。

AI 带动半导体行业需求扩张，已不仅在关键的计算芯片领域，围绕数据中心等应用场景的互联芯片、存储芯片、功率芯片等品种都已充分受益。2026 年以来，行业发展与技术出新愈发火热，费城半导体指数快速拔升。**半导体材料作为行业最上游，在本轮成长周期中亦景气高企。**2026 年 Q1 **全球硅片出货量同比增长 13%，已经是连续第 7 个季度出货量同比增长。**

图1：全球硅片出货量连续修复，半导体材料需求进入上行阶段



数据来源：Wind、开源证券研究所

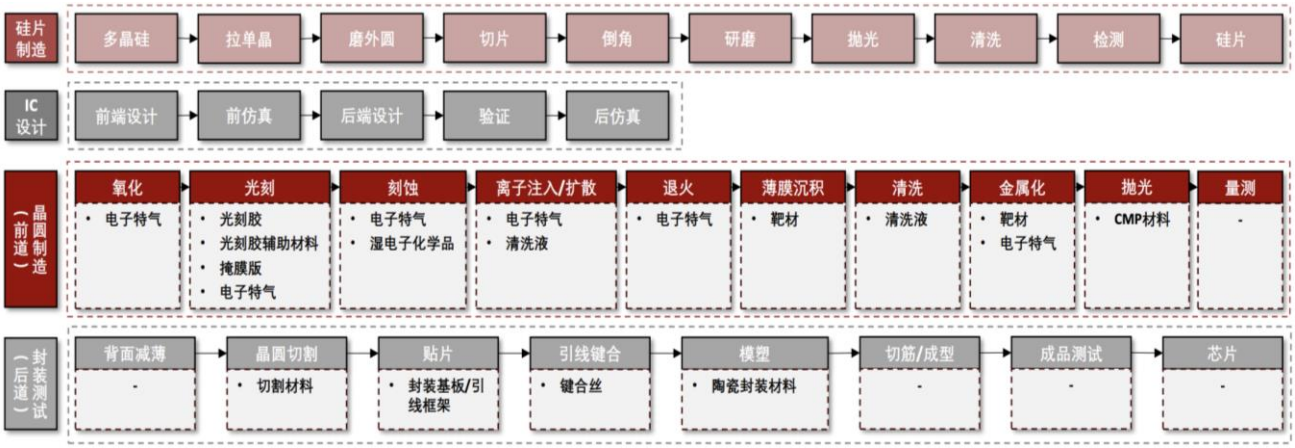
下载日志已记录，仅供内部参考

1.2、 半导体材料市场规模再创新高，湿化学品市场增速突出

1.2.1、 工艺流程：材料是支撑制造与封装工艺的关键基础

半导体材料广泛应用于晶圆制造与封装测试各环节，是支撑芯片制造的核心耗材。就晶圆制造流程而言，从多晶硅提纯、拉单晶、切片、倒角、研磨、抛光、清洗、检测等硅片制备工序，到氧化、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、清洗、金属化、CMP（化学机械抛光）、量测等前道工艺，均需大量专用材料配套。除硅片外，关键材料还包括电子特气、光刻胶及其辅助材料、湿电子化学品、溅射靶材、前驱体、CMP 材料等。封装测试环节同样涉及切割材料、键合丝、引线框架、封装基板、陶瓷封装材料等多类材料。总而言之，材料需求贯穿半导体生产的几乎每一道工序。

图2：半导体制造环节涉及多种不同材料



资料来源：头豹

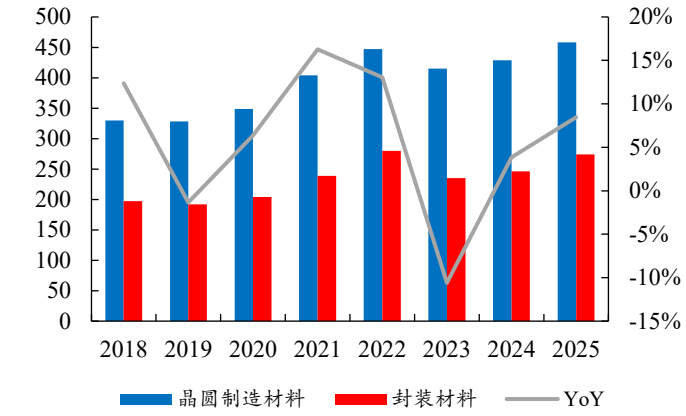
1.2.2、 市场规模：半导体景气上行带动全球材料市场销售额新高

2025 年全球半导体材料市场规模已达到 732 亿美元。从市场规模看，根据 SEMI 的数据，全球半导体材料市场规模由 2023 年的 650 亿美元提升至 2025 年的 732 亿美元。其中，晶圆制造材料市场规模由 2023 年的 415 亿美元增长至 2025 年的 458 亿美元，封装材料市场规模由 2023 年的 235 亿美元增长至 2025 年的 274 亿美元。预计到 2026 年，全球晶圆制造材料市场规模将达到 489 亿美元，细分类别中，硅片为最大单一品类，2026 年市场规模预计达到 143 亿美元；电子气体、掩膜版、湿电子化学品、CMP 抛光液及垫等材料规模稳步提升，反映晶圆厂投片需求修复及先进制程工艺复杂度提升对制造材料需求形成共同拉动；整体来看，半导体材料市场在经历阶段性调整后已重新进入上行通道。

中国大陆半导体材料市场空间在 2025 年达到 156 亿美元，折算人民币已超千亿，占比较高，规模增速最快。从区域结构看，2025 年中国台湾、中国大陆、韩国仍是全球半导体制造材料的主要市场，其中中国台湾占比约 29.6%，中国大陆占比约 21.3%，韩国占比约 15.3%。根据 SEMI 的数据，中国大陆 2025 年市场规模达到 156 亿美元/yoy+12.5%，在主要地区中增速最快，主要受益于本土晶圆厂扩产、成熟制程产能释放以及半导体材料国产化进程加速。中国大陆已成为全球半导体制造材料需求增长的重要增量市场。

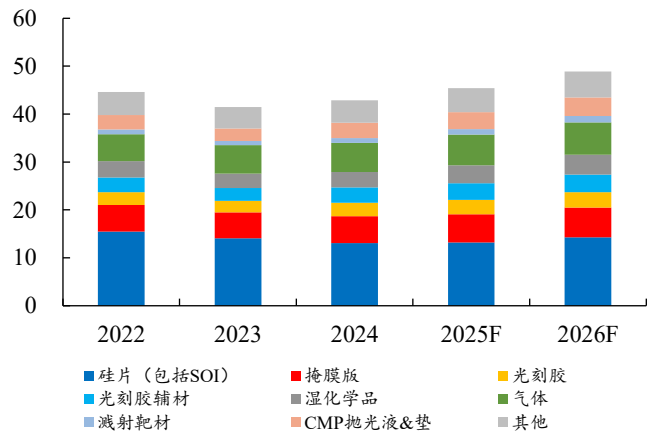
下载日志已记录，仅供内部参考

图3：全球半导体材料规模持续上行（亿美元）



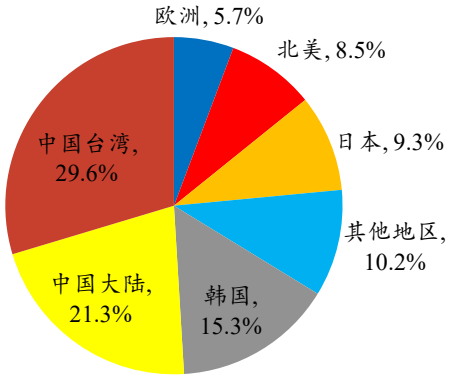
数据来源：SEMI、开源证券研究所

图4：硅片仍为最大晶圆制造材料，湿化学品与 CMP 占据重要份额（亿美元）



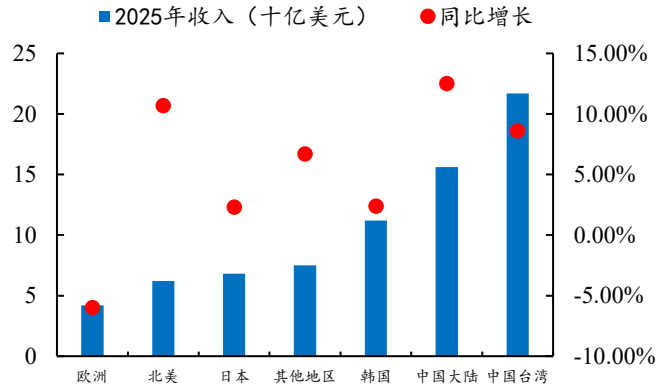
数据来源：SEMI、开源证券研究所

图5：中国大陆已成为全球第二大半导体材料市场



数据来源：SEMI、开源证券研究所

图6：2025 年中国大陆半导体材料市场增速领先大部分主要地区



数据来源：SEMI、开源证券研究所

1.2.3、 湿化学品：贯穿制造流程，市场增速突出

湿电子化学品是晶圆制造中的关键过程材料，广泛应用于硅片制造、晶圆制造及光罩制造等多个环节。在集成电路制造流程中，湿电子化学品主要用于清洗、显影、刻蚀、剥离、表面处理、化学机械抛光后清洗等工艺步骤，贯穿从硅片加工到光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积及封装前处理等环节，具有高频使用、工艺适配性强、纯度要求高的特点

从材料品类来看，广泛意义上呈现为液态的“湿化学品”并非单一品类。狭义而言，通用型湿化学品至少包括各类酸、碱及有机溶剂等基础化学品；进一步扩展，功能型湿化学品则涵盖显影液、去胶剂、清洗液等专用配方型材料。

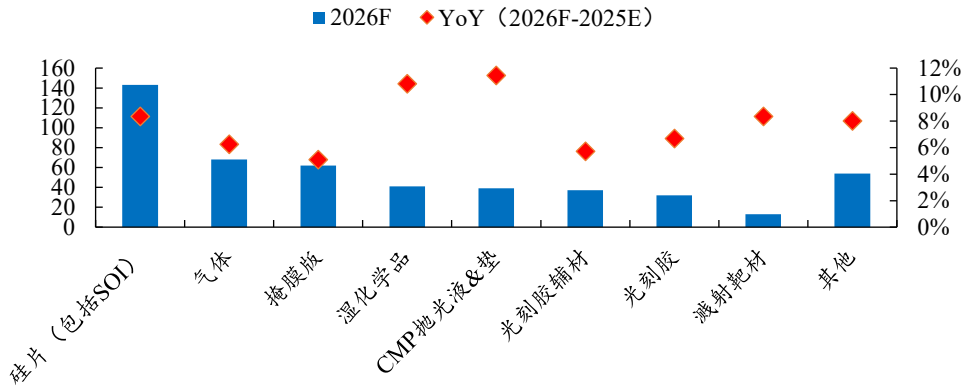
湿电子化学品及相关材料在晶圆制造材料市场中占据重要份额，且市场需求正稳步扩容，其中湿化学品与 CMP 材料的增速尤为突出。根据 SEMI 的数据，2024

下载日志已记录，仅供内部参考

年全球晶圆制造材料市场规模为 429 亿美元，其中湿电子化学品、光刻辅助材料、CMP 抛光液及垫均分别占比约 7.5%，三者合计占比约 22.5%。从三类包含泛湿电子化学品的市场规模看，预计将由 2024 年的 9.6 亿美元提升至 2026 年的约 11.7 亿美元，整体保持稳步增长。进一步结合 SEMI 对 2025 年及 2026 年的市场预测进行横向对比，湿化学品与 CMP 材料在各晶圆制造材料类别中增速相对领先，双双达到两位数增长率。

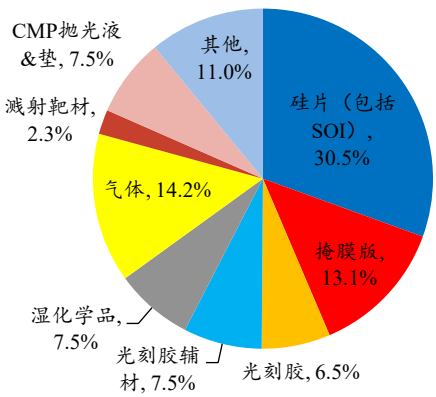
我们认为，随晶圆制造厂投片量持续上行，整个材料市场有望充分受益。更关键的是，新增晶圆制造产能多集中于先进制程工艺以及 3D NAND、HBM 等高端芯片领域，图形化工艺步骤相应增加，进而带动配套的清洗、刻蚀、CMP 等工艺环节需求提升。晶圆制造市场的结构性变化为湿电子化学品及相关配套材料需求的超额增长提供了有力支撑。

图7：2026 年湿化学品与 CMP 材料增速预计领先晶圆制造材料大盘



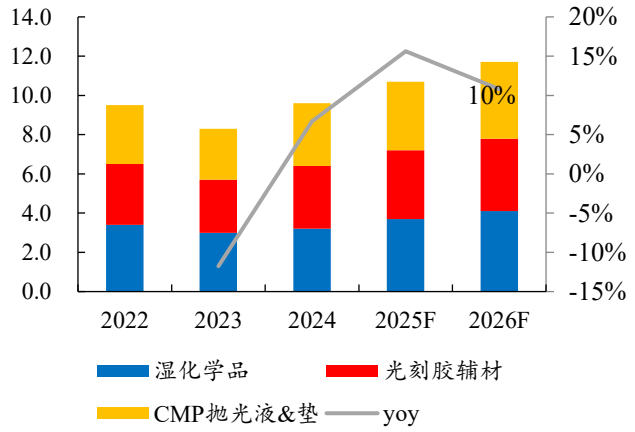
数据来源：SEMI、开源证券研究所

图8：湿电子化学品占据重要份额



数据来源：SEMI、开源证券研究所

图9：含泛湿电子化学品的市场规模稳步提升（亿美元）



数据来源：SEMI、开源证券研究所

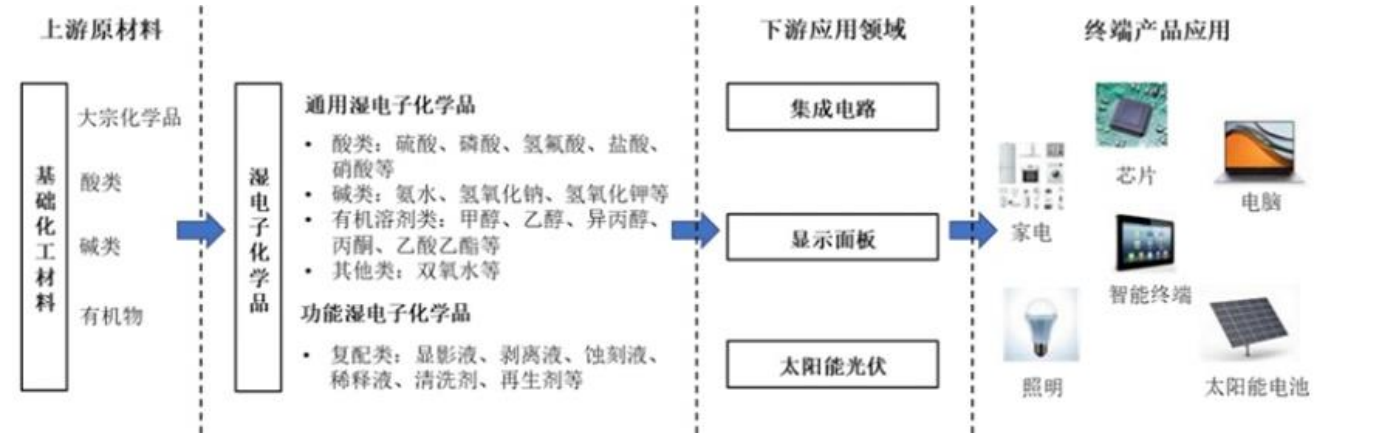
下载日志已记录，仅供内部参考

2、 需求扩容+国产替代，湿电子化学品步入发展快车道

2.1、 应用场景：集成电路、面板与光伏协同驱动湿化学品需求增长

湿电子化学品位于基础化工材料与电子制造产业之间。上游主要包括酸类、碱类、有机物等基础化工原料，经过提纯、配方开发和品质控制，可分别制得通用电子化学品及功能型电子化学品。其中，通用类产品包括硫酸、硝酸、磷酸、氢氟酸、盐酸、氨水、双氧水、异丙醇等；功能类产品则包括显影液、剥离液、蚀刻液、清洗剂、再生剂等。从下游应用看，湿电子化学品广泛用于集成电路、显示面板和太阳能光伏等领域，是清洗、刻蚀、显影、剥离、电镀等湿法工艺中的基础耗材。其最终应用覆盖芯片、电脑、智能终端、家电、照明及太阳能电池等电子产品。

图10：湿电子化学品上下游产业链



资料来源：兴福电子招股说明书

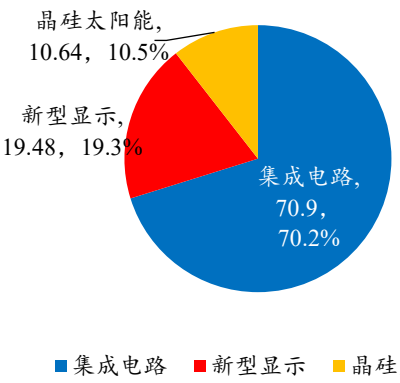
从全球湿化学品市场看，集成电路用湿化学品市场规模较大，光伏行业用湿化学品用量最高。

从市场规模看，根据中国电子材料行业协会统计和测算，2024 年全球湿化学品总市场规模达到 101.02 亿美元，其中集成电路是湿电子化学品最主要的需求来源，占比约 70.2%，新型显示占比约 19.3%，晶硅太阳能占比约 10.5%。

从需求量看，太阳能领域是湿电子化学品需求量最大的应用方向，2024 年需求量约 222.8 万吨，主要受光伏电池片大规模产能释放及清洗、制绒、刻蚀等湿法工艺用量较大带动。显示面板领域需求基本保持稳健，2024 年需求量约 102.8 万吨，主要来自面板制造过程中的清洗、显影、蚀刻、剥离等环节。集成电路领域需求量约 125.4 万吨，绝对用量低于光伏，但对产品纯度、金属离子控制和工艺稳定性要求更高，产品单价显著更高。随全球半导体制造进入新一轮上行周期，集成电路用湿化学品的需求有望持续提升，进一步带动整体市场规模增长。

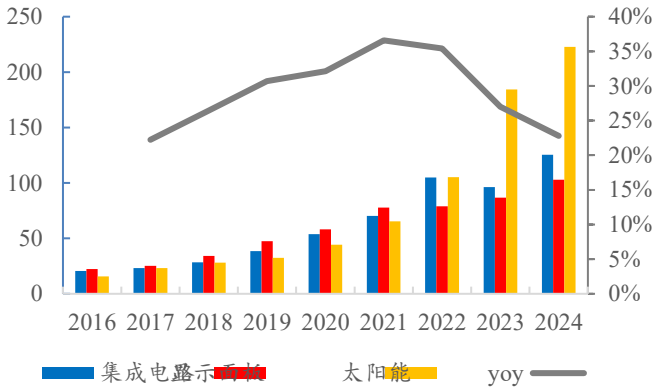
下载日志已记录，仅供内部参考

图11：集成电路用湿化学品市场规模较大（2024 年）



数据来源：CEMIA、开源证券研究所

图12：湿电子化学品三大应用场景需求量（万吨）



数据来源：CEMIA、开源证券研究所

湿电子化学品按照用途可分为通用型和功能型两大类。通用类产品主要包括酸类、碱类、有机溶剂及其他基础化学品，如硫酸、盐酸、氢氟酸、氨水、双氧水、等，主要承担清洗、腐蚀、表面处理等基础工艺功能。功能类产品则更多面向特定工艺配方和应用场景，包括刻蚀液、清洗液、显影液、剥离液等。其中，刻蚀液可用于金属刻蚀、ITO 刻蚀、硅刻蚀等环节；清洗液用于铜抛光后清洗、铝工艺刻蚀后清洗、去胶后清洗等；显影液、剥离液则主要服务于光刻及图形转移流程。

表1：湿电子化学品种类丰富

类别	子类别		品名
通用电子湿化学品	酸类		氢氟酸、硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、乙酸等
	碱类		氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等
	有机溶剂类	醇类	甲醇、乙醇、异丙醇等
		酮类	丙酮、丁酮、甲基异丁基酮等
		脂类	乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯等
		烃类	甲苯、二甲苯、环己烷等
		卤代烃类	三氯乙烯、三氯乙烷、氯甲烷、四氯化碳等
	其他类		双氧水等
功能电子湿化学品	刻蚀液		金属刻蚀液、缓冲氧化物刻蚀液、ITO 刻蚀液、硅刻蚀液等
	清洗液		铜抛光后清洗液、铝工艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液、HKMG 假栅去除后清洗液、去溢料清洗液
	光刻胶配套试剂	稀释液	丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚、乳酸乙酯
		显影液	正胶显影液、负胶显影液等
		剥离液	正胶剥离液、负胶剥离液、剥离清洗液、酸性剥离液等

资料来源：中巨芯招股说明书、开源证券研究所

不同应用领域对湿电子化学品等级要求存在明显差异。根据 SEMI 标准，低等级产品主要用于分立器件、太阳能光伏等领域；中等级产品可用于显示面板、LED 等领域；高等级产品则主要用于集成电路制造。随着等级从 G1 提升至 G5，产品在适应 IC 线宽、金属杂质含量、控制粒径、颗粒数量等指标上要求持续提高，尤其 G4、G5 等级主要面向集成电路，对纯度、洁净度和稳定性要求更为严格。

下载日志已记录，仅供内部参考

表2：不同应用领域湿电子化学品等级要求不同

SEMI 标准	适应 IC 线宽/μm	金属杂质/μg/L	控制粒径/μm	颗粒/颗/ml	主要应用
G1	>1.2	≤100	≤1.0	≤25	分立器件、太阳能光伏
G2	0.8~1.2	≤10	≤0.5	≤25	分立器件、显示面板、LED
G3	0.2~0.6	≤1.0	≤0.5	≤5	显示面板、LED、集成电路
G4	0.09~0.2	≤0.1	≤0.2	需双方协商	集成电路
G5	<0.09	≤0.01	需双方协商	需双方协商	集成电路

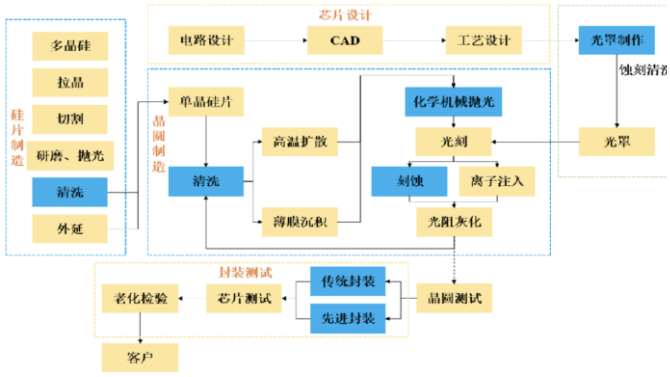
资料来源：SEMI、开源证券研究所

2.2、 集成电路：扩产周期与工艺升级驱动，湿电子化学品量价齐升

集成电路制造是湿电子化学品的重要应用领域，相关产品广泛用于晶圆制造和封装测试环节。硅片、晶圆制造主要湿法工艺包括：扩散前/刻蚀后/离子注入后/光阻灰化后/成膜前后清洗、晶背和晶边清洗、湿法刻蚀、化学机械抛光后清洗等；封装主要湿法工艺包含：TSV 清洗、UBM/RDL 清洗、键合清洗等。

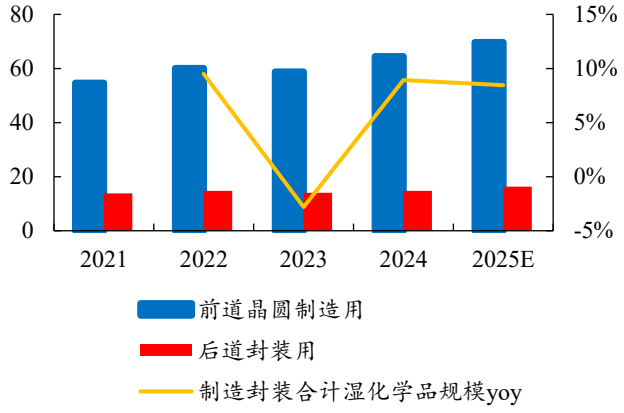
晶圆制造用湿电子化学品占比集成电路领域预计约 80%左右。以中国市场为例，根据中国电子材料行业协会数据，集成电路用湿电子化学品需求整体保持增长，2021 年至 2025 市场规模由 68.4 亿元增长至 86.0 亿元，其中前道晶圆制造用湿电子化学品占比长期维持在 80%左右，主因前道工艺对湿电子化学品的使用场景更为密集，广泛覆盖晶圆清洗、湿法刻蚀、光刻配套、CMP 后清洗、电镀等多个制程步骤。同时，前道制造涉及更高精度的图形转移与更严格的污染控制，对产品的纯度、金属离子含量、颗粒控制及批次一致性要求更高，因此也成为高等级湿电子化学品的主要应用方向。后道封装规模相对较小，但受益于先进封装工艺的发展，同样保持稳步增长。

图13：湿电子化学品在集成电路制造中的应用



资料来源：中巨芯招股说明书、开源证券研究所

图14：中国集成电路用湿化学品市场稳步增长，前道制造贡献主要需求（亿元）



数据来源：CEMIA、开源证券研究所

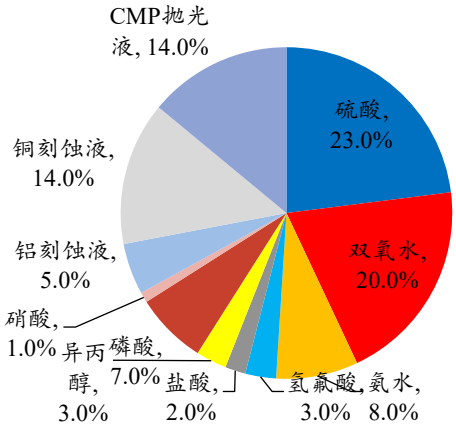
从产品结构看，据 TECHCET 测算 2023 年数据，在诸多湿化学品品类中，硫酸、双氧水、CMP 抛光液、铜刻蚀液、氨水等品类占比较高。其中硫酸占比约 23%，双氧水占比约 20%，CMP 抛光液和铜刻蚀液各占约 14%。上述结构表明，清洗、氧化、

下载日志已记录，仅供内部参考

刻蚀及平坦化相关材料或构成了集成电路制造中最主要的湿化学品需求。

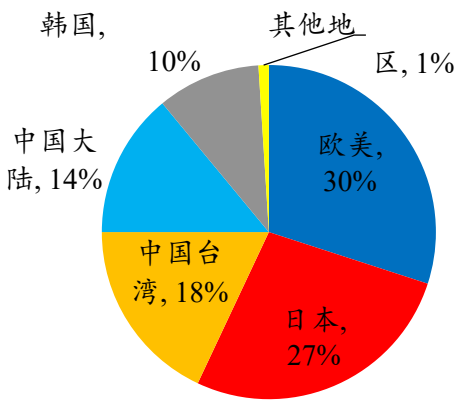
从地区格局来看，据 2023 年数据，在湿电子化学品领域，欧美、日本、中国台湾仍占据全球主要份额，分别约为 30%、27%和 18%；中国大陆市场份额约 14%，具备一定产业规模，但仍存在提升空间。**我们认为，结合中国晶圆制造产能扩张和高等级材料国产替代推进，国内集成电路用湿电子化学品市场仍具备较大的结构性增长空间。**

图15：2023 年全球集成电路用湿电子化学品细分占比



数据来源：TECHCET、开源证券研究所

图16：2023 年湿电子化学品领域：欧美、日本、中国台湾仍占据全球主要份额，分别约为 30%、27%和 18%

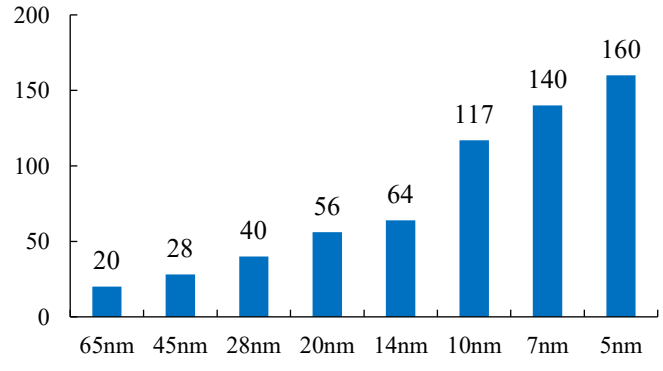


数据来源：CEMIA、开源证券研究所

2.2.1、 逻辑芯片：制程升级，图案化步骤增加带动需求提升

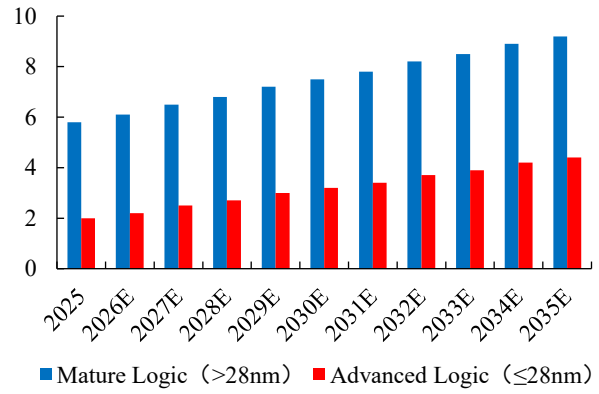
逻辑芯片制程持续向先进节点演进，制造流程中的图形化、刻蚀、清洗和表面处理步骤显著增加，直接带动湿化学品用量提升。以刻蚀次数为例，随着制程节点由 65nm 向 5nm 推进，晶圆刻蚀次数由约 20 次提升至约 160 次，工艺复杂度明显上升。刻蚀步骤增加不仅直接提升刻蚀液、清洗液等湿电子化学品用量，也对产品选择性、稳定性、金属杂质控制和颗粒控制提出更高要求。

图17：逻辑芯片制程升级驱动晶圆刻蚀次数上升



数据来源：华经产业研究院、开源证券研究所

图18：成熟与先进逻辑晶圆需求均有望持续增长（百万片/月）



数据来源：ASML，EE Times Japan、开源证券研究所

从晶圆需求结构看，EE Times Japan 基于 ASML Investor Day 2024 披露的晶圆

下载日志已记录，仅供内部参考

需求预测进行测算，成熟逻辑与先进逻辑晶圆需求均有望保持增长。成熟逻辑制程由于应用范围广、需求基数大，预计月需求量从 2025 年的 580 万片增长至 2035 年的 920 万片；先进逻辑制程则受高性能计算、AI、智能终端等需求推动，预计月需求量从 2025 年的 200 万片增长至 2035 年的 440 万片。随着先进逻辑占比提升，高等级湿电子化学品需求将同步增加。

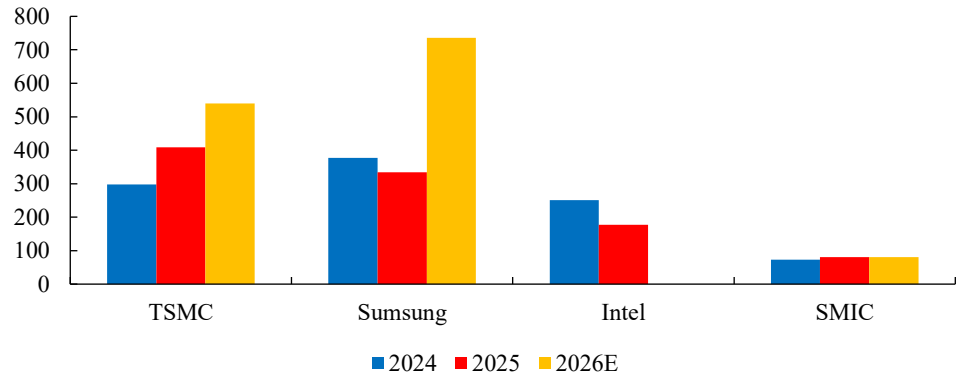
图19：逻辑芯片技术路线图：更复杂工艺对于湿化学品有更高要求

Year of HVM (20k/month)	2022~24	2025~2026	2027~28	2029~30	2031~32	2033~34	2035~36	2037~38
Node	3nm	2nm/18A/16A	14A	10A	7A	5A	3A	2A
Transistor	2~1 Fin	GAA NS	GAA NS scaling	GAA NS extension	CFET	2nd Gen. CFET	3rd Gen. CFET	2D material stack
Poly Pitch [nm]	48~45 [1]		45~42		48 [3] ~42	45~39		36
Min. Metal Pitch [nm]	23 [2]		20	18	17	16	14	12
Interconnect booster	Cu Barrier/Seed CIP Backside PDN (HPC)			Cu CIP or Ru subtractive	Ru subtractive AR>3, Airgap	New alloy AR>5, Airgap, BEOL Transistor		
EUV Patterning Technology	EUV MP*1, SE*2			EUV MP, SE High-NA SE		High-NA MP, SE EUV MP, SE		
Resist	CAR*3			CAR (+MOR*4)		CAR+MOR		

资料来源：TEL

逻辑芯片制程持续演进推动湿电子化学品向更高纯度、更高选择性和更强工艺适配能力升级。随着制程节点由 3nm、2nm 进一步向 A14、A10、A7 及更先进节点演进，晶体管结构从 FinFET 逐步演进至 GAA、CFET 乃至 2D 材料堆叠，器件结构复杂度显著提升；同时金属间距、Poly Pitch 持续缩小，互连材料由铜体系逐步引入钌、新合金及低介电常数材料，对清洗、刻蚀、去胶、表面处理等湿法工艺提出更严苛要求。先进制程下，湿电子化学品不仅需要满足金属离子、颗粒、有机残留等杂质的超低控制标准，还需在多材料共存环境下实现精准选择性，避免对低 k 介质、金属互连及新型晶体管结构造成损伤。因此，逻辑芯片技术迭代带动湿化学品从“基础清洗耗材”向“高纯度、功能化、定制化工艺材料”升级，推动高等级湿电子化学品需求持续提升。

图20：2026 年头部晶圆厂继续加码先进制造资本开支（亿美元）



数据来源：公司官网、开源证券研究所

全球主要晶圆厂 2026 年资本开支计划再创新高，先进逻辑和高端制造产能仍是投资重心，这将直接拉动相关湿电子化学品的用量与等级要求同步提升。其中，TSMC 预计 2026 年资本开支为 600–640 亿美元，Samsung 预计为 786 亿美元，SMIC

下载日志已记录，仅供内部参考

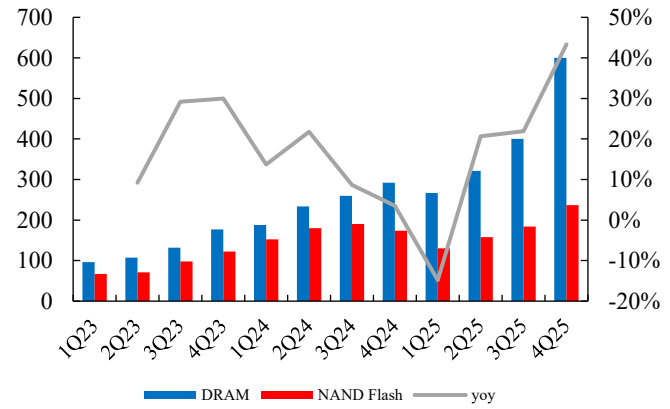
预计为 81 亿美元。随着头部晶圆厂持续加码先进制程与产能建设，逻辑芯片制造环节对高纯硫酸、双氧水、氨水、氢氟酸、显影液、剥离液、刻蚀液、CMP 后清洗液等湿电子化学品的需求预计进一步扩大。

2.2.2、 存储芯片：3D 化与堆叠层数倍增，拉动湿化学品需求提升

全球 DRAM 与 NAND 市场自 2023 年低点后明显修复，2024 年以来进入上行周期，市场规模显著升高。根据 CFM 的数据，按季度数据看，DRAM 市场规模由 2023 年 Q1 的 96 亿美元提升至 2025 年 Q4 的 600 亿美元，NAND Flash 市场规模由 2023 年 Q1 的 87 美元提升至 2025 年 Q4 的 237 亿美元。本轮市场规模扩张主要受存储芯片价格回升驱动。

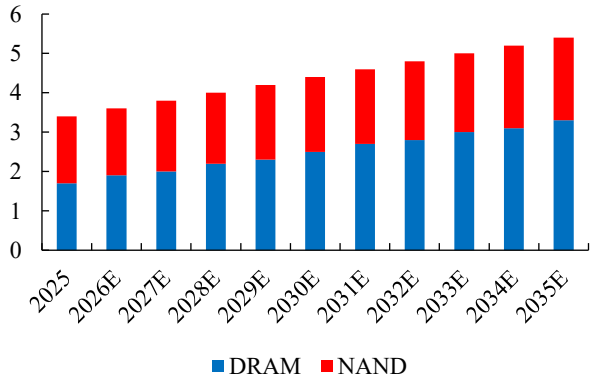
往后看，存储晶圆需求持续增长，叠加技术结构升级，将为湿电子化学品需求提供有力支撑。根据微细加工研究所的预测，DRAM 与 NAND 晶圆需求量预计持续增长。DRAM 月需求量预计由 2025 年的 170 万片提升至 2035 年的 330 万片，NAND 月需求量预计由 2025 年的 170 万片提升至 2035 年的 210 万片。存储晶圆需求扩张与技术迭代并行推进，共同拉动清洗、刻蚀、CMP 后清洗等环节所用湿电子化学品的用量与等级要求提升。

图21：全球 DRAM 和 NAND 季度市场规模（亿美元）



数据来源：CFM、开源证券研究所

图22：DRAM 晶圆需求增速预计快于 NAND（百万片/月）



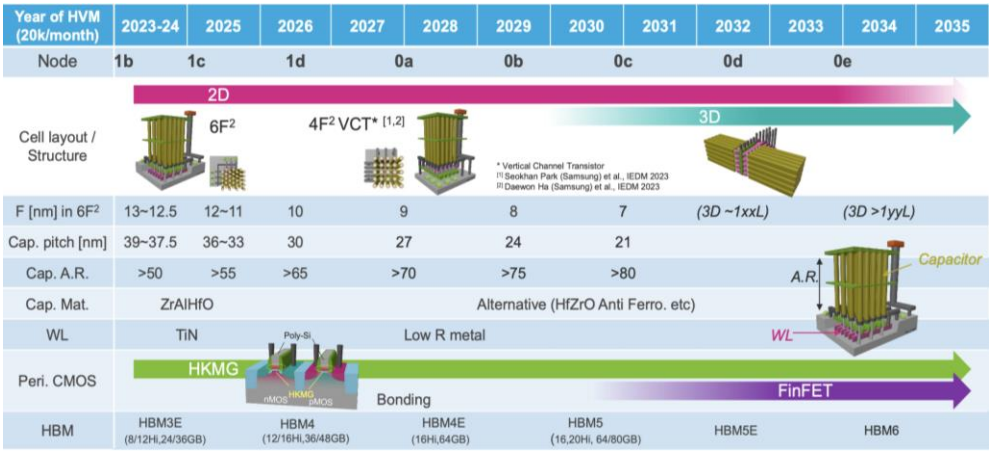
数据来源：EE Times Japan、开源证券研究所

与逻辑芯片注重制程升级不同，存储芯片更强调高密度存储结构的持续演进。存储芯片是集成电路中湿电子化学品的重要应用领域，其中 DRAM 由 2D 结构逐步向 3D 结构发展，NAND 则早已步入 3D 结构时代，3D NAND 主要通过堆叠层数的增加来实现容量扩张。结构复杂度提升意味着薄膜沉积、刻蚀、清洗、表面处理等工艺步骤增加，对湿电子化学品的用量和洁净度要求同步提高。

从 DRAM 技术路线看，制程节点持续向 1b、1c、1d 及后续节点演进，电容结构、字线材料、外围 CMOS 等环节不断优化。随着线宽缩小和结构纵向化，晶圆制造过程中对颗粒、金属离子和残留物的控制要求更加严格，驱动清洗液、刻蚀液、剥离液、显影液、CMP 后清洗液等产品向更高纯度与更强稳定性升级。

下载日志已记录，仅供内部参考

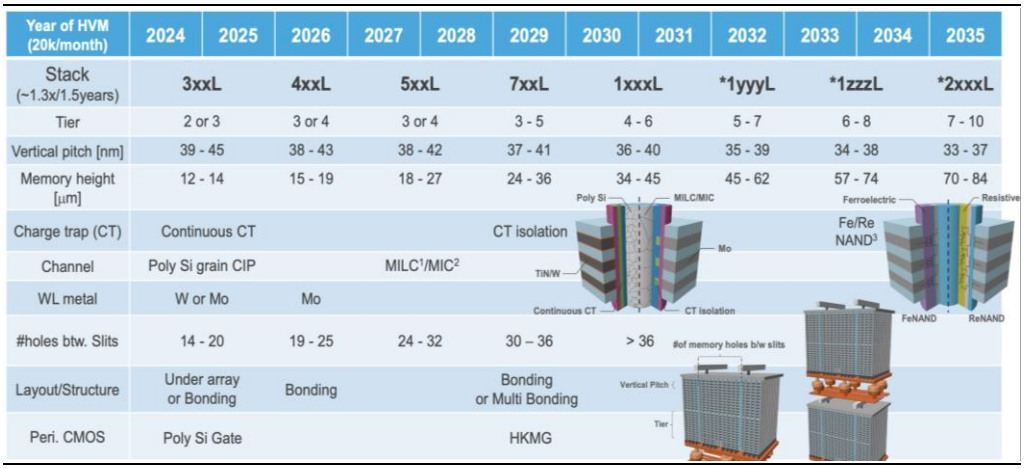
图23：DRAM 技术路线愈加复杂，湿化学品需配套升级



资料来源：TEL

NAND 的升级路径则更直接体现为 3D 堆叠层数快速提升。其核心逻辑不是单纯依靠平面线宽微缩，还包括通过垂直方向增加存储层数来提升存储密度。从百层级向数百层乃至千层级演进的过程中，沟道孔、阶梯结构、深孔刻蚀和多层膜堆结构显著增加，制造流程更长、结构更复杂，单片晶圆对应的湿化学品消耗量也更具弹性。同时，高深宽比结构对清洗均匀性、残留控制和材料兼容性提出更高要求，也会推动高纯湿化学品及功能型湿化学品需求提升。

图24：3D NAND 技术路线图：堆叠层数持续增加，单位材料需求增长



资料来源：TEL

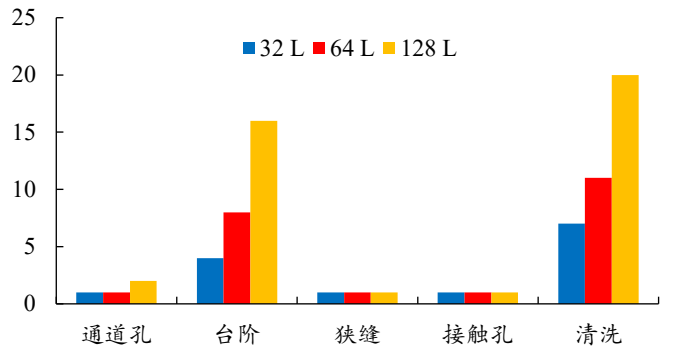
3D NAND 高层化趋势下，工艺次数倍增，湿化学品消耗量加速攀升。从各独立工艺加工次数看，层数提升对部分关键环节的拉动较为明显。据程星华等人《3D NAND 存储芯片刻蚀设备选型和数量配置研究》，台阶工艺加工次数由 32L 的 4 次提升至 128L 的 16 次，清洗工艺加工次数由 7 次提升至 20 次，是增幅最明显的环节，相应材料消耗量将显著增加。另据 Entegris（美股代码：ENTG.O）数据，176 层 3D NAND 芯片的单位晶圆材料消耗约为 32 层的 1.6 倍，500 余层则扩大至 3.0 倍，结构升级带动的单位晶圆材料消耗量倍增效应突出。3D NAND 持续向高层数及高密度方向演进，制造工艺复杂度进一步提升。铠侠 2026 年 Investor Day 披露，第 10 代 BiCS FLASH 采用 332 层堆叠，并通过横向微缩等技术实现较第 8 代约 59%的位密度提升；公司后续第 11 代产品仍将结合垂直堆叠与横向微缩推进密度提升。层数快速提升将进一步放大关键工艺环节的加工需求，从而带动湿化学品等材料的需求量

下载日志已记录，仅供内部参考

快速增长。

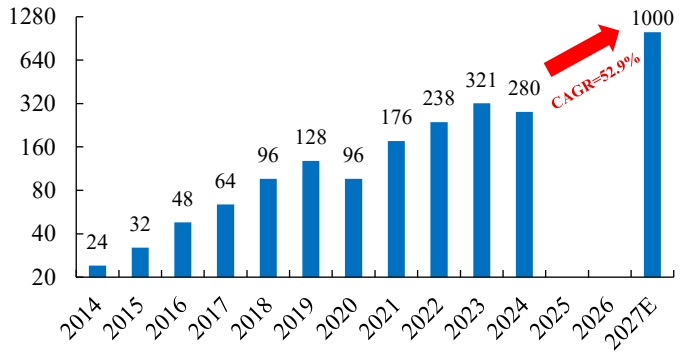
因此，综上所诉，我们认为湿化学品市场增长，除了受益于晶圆厂扩产带来的基础增量外，还应叠加考虑工艺复杂度提升而产生的额外需求。

图25：NAND 层数提升显著增加台阶与清洗工艺次数



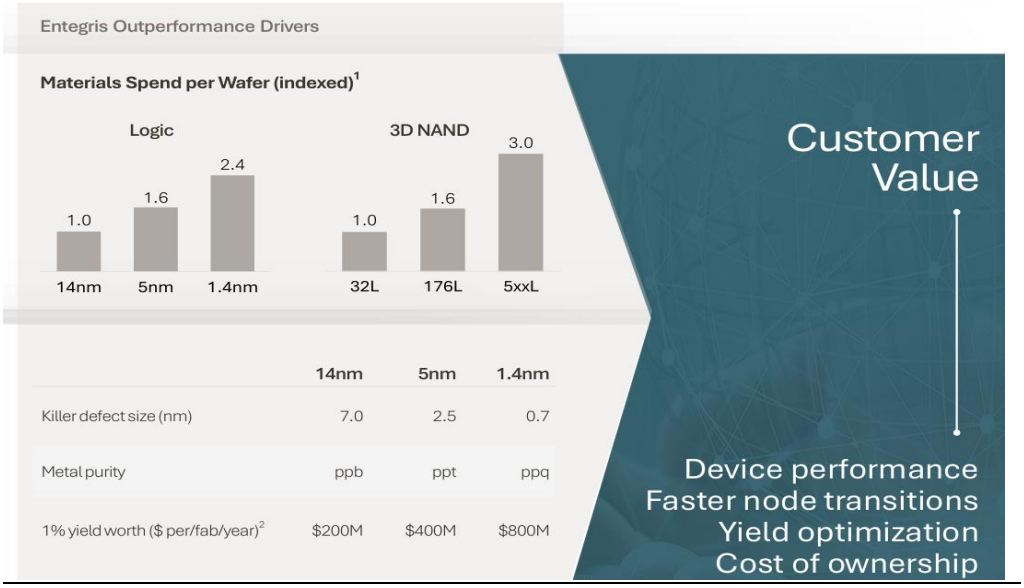
数据来源：程星华、曹东、白帆、宋恺等《3D NAND 存储芯片刻蚀设备选型和数量配置研究》、开源证券研究所

图26：3D NAND 堆叠层数加速迈向 300 层以上



数据来源：PC Watch、开源证券研究所

图27：逻辑芯片制程升级与 3D NAND 层数提升都将带动单位晶圆消耗材料提升



资料来源：Entegris

2.2.3、 先进封装：后摩尔时代技术创新，材料需求持续释放

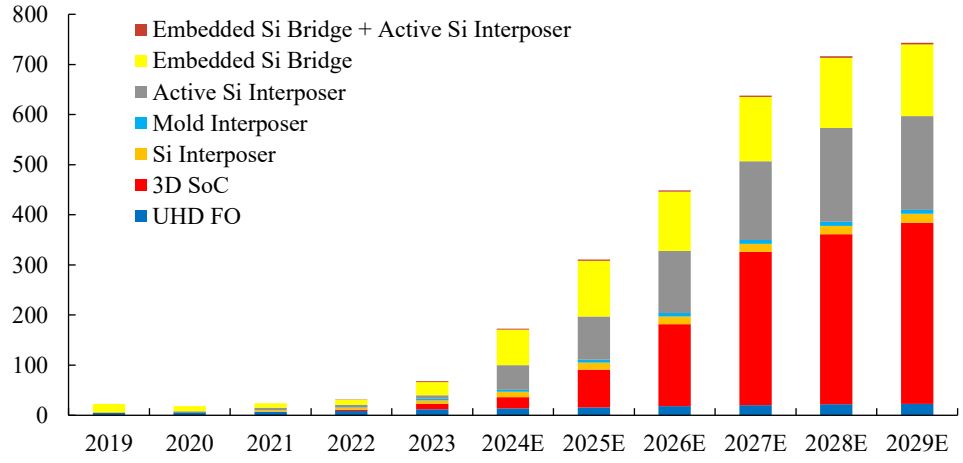
先进封装环节涉及多种电子化学品，应用贯穿各种不同工艺。先进封装应用包括重布线层、硅中介层、3D 集成、凸点、TSV、临时键合/解键合等关键工艺。与传统封装相比，先进封装不再只是简单的芯片保护和电气连接，而是进一步承担高密度互连、异质集成和系统级性能提升的功能，因此对光刻胶、刻蚀/清洗液、电镀液、去胶液、助焊剂清洗液以及 CMP 抛光液等材料提出更高要求。

后摩尔时代，高端先进封装有望快速发展。根据 Yole 的数据，UHD FO、3D SoC、Si Interposer、Mold Interposer、Active Si Interposer、Embedded Si Bridge 等高端封装

下载日志已记录，仅供内部参考

形式整体出货量预计从 2023 年的约 66 百万颗增长至 2029 年的约 740 万颗，2023~2029 年复合增速约 50%

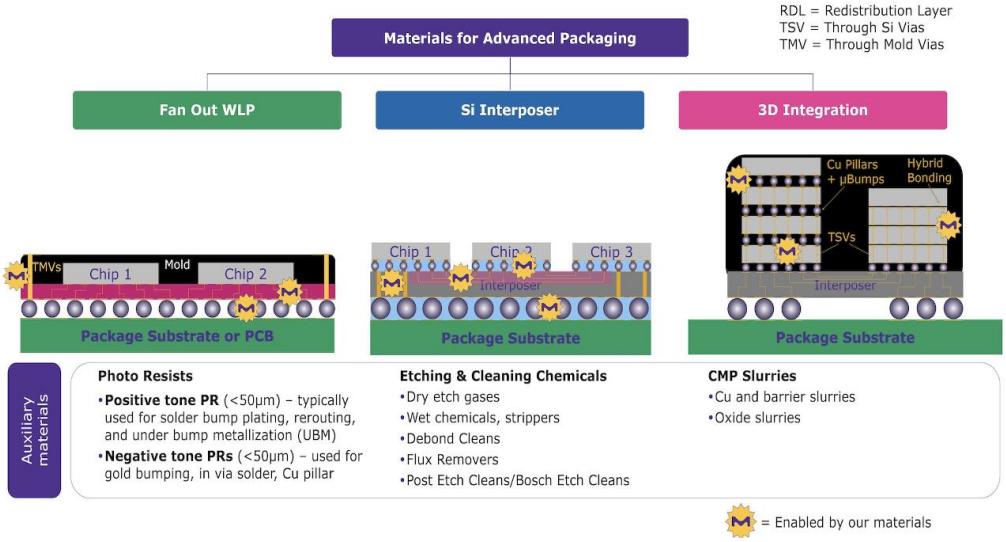
图28：高端封装出货量预计 2023—2029 年增长约 10 倍（百万颗）



数据来源：Yole、开源证券研究所

从具体应用看，Fan-out WLP、Si Interposer 和 3D Integration 等先进封装路线均需要使用湿电子化学品。以硅中介层和 3D 集成为例，TSV、RDL、Cu Pillar、Micro-bump 等结构通常需要经历光刻、显影、刻蚀、清洗、电镀、去胶、CMP 等多道工艺，对湿法化学品的用量和纯度要求均明显提升。

图29：先进封装环节湿电子化学品的应用



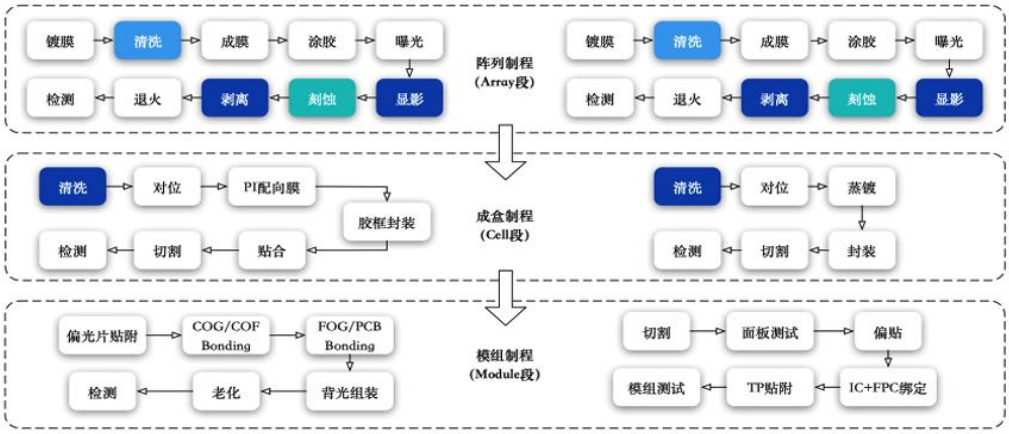
资料来源：EMD Electronics

2.3、 显示面板：面板制造需求增长，湿化学品用量稳步提升

显示面板制造是湿电子化学品的重要应用场景。相关材料用于阵列制程、成盒制程和模组制程等多个环节。从面板制造流程看，清洗、显影、刻蚀、剥离等湿法工艺是形成 TFT 电路、像素结构和电极图形的关键步骤。

下载日志已记录，仅供内部参考

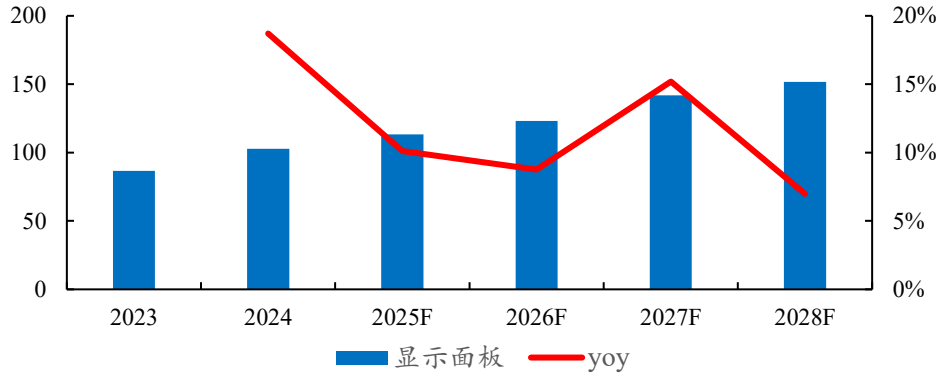
图30：湿电子化学品用于光伏电池片制造的清洗/蚀刻过程



资料来源：润玛电子招股说明书

根据中国电子材料行业协会的预测，显示面板领域湿电子化学品需求量将由2024年的102.8万吨/yoy+19.0%提升至2028年的151.7万吨，期间CAGR约10.2%，2024年同比增长19%，主要受面板行业稼动率修复及下游需求回暖带动。

图31：中国显示面板用湿电子化学品需求量有望稳步提升（单位：万吨）

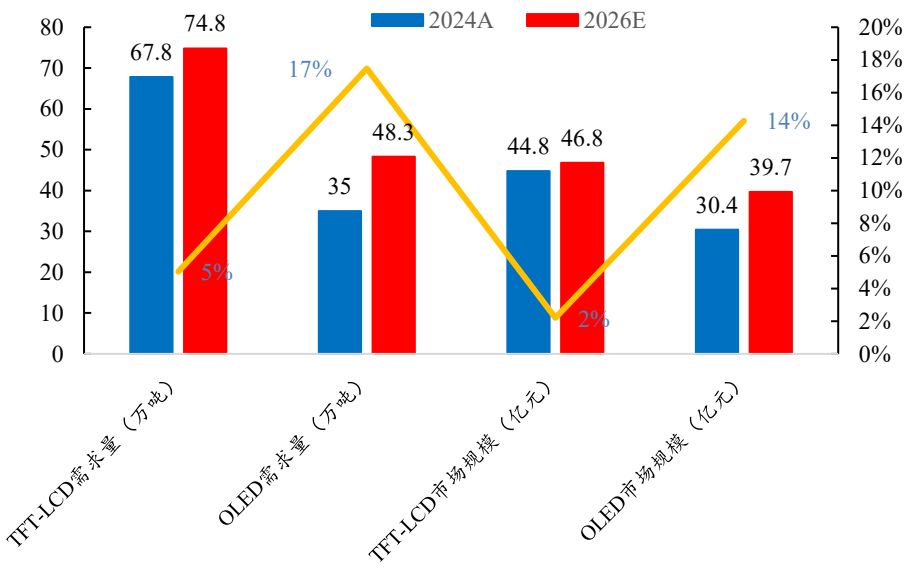


数据来源：CEMIA、开源证券研究所

显示面板主要包括TFT-LCD和OLED两类，二者使用湿电子化学品的品类结构具有一定差异。根据中国电子材料行业协会《2025版湿化学品产业研究报告》，2024年中国TFT-LCD和OLED用湿电子化学品需求量分别为67.8万吨和35.0万吨，预计2026年分别增至74.8万吨和48.3万吨，对应2024—2026E CAGR分别约为5.0%和17.5%，TFT-LCD当前需求规模较大，而OLED需求增速相对更快。从产品结构看，TFT-LCD湿法制程涉及显影液、剥离液以及铜、铝、ITO等金属或导电层蚀刻液；OLED除显影液、剥离液等品类外，还涉及银蚀刻液、低腐蚀蚀刻液等针对特定电极及材料体系的功能性产品。整体来看，TFT-LCD仍构成显示面板湿电子化学品的重要需求基础，OLED需求增长则为银蚀刻液等专用功能性湿电子化学品带来新的应用增量。

下载日志已记录，仅供内部参考

图32：OLED 需求量和市场规模增长快于 TFT-LCD（需求量单位：万吨；市场规模单位：亿元）



数据来源：CEMIA、开源证券研究所

表3：TFT-LCD 与 OLED 不同维度的对比

维度	TFT-LCD	OLED	区别
	TFT 阵列+液晶层+彩膜等构成，产业成熟度较高	TFT 阵列基础上叠加 OLED 发光、电极等结构，对材料及图形化工艺要求更复杂	OLED 对材料兼容性、选择性及工艺适配要求更高
主要湿法工艺	清洗、显影、金属蚀刻、ITO 蚀刻、剥离等	清洗、显影、剥离、金属/电极蚀刻等，部分工艺需要针对 OLED 材料体系开发专用配方	二者均大量使用功能性湿化学品，但 OLED 专用配方需求更加突出
典型湿电子化学品	铜系蚀刻液、铝系蚀刻液、剥离液、显影液、ITO 蚀刻液、清洗液	银蚀刻液、显影液、剥离液、低腐蚀蚀刻液、清洗液等	LCD 偏向成熟的大宗功能性品类；OLED 增加银蚀刻、低腐蚀蚀刻等专用材料
产品需求特征	需求规模较大，高世代线生产强调稳定供应、良率与成本	配方针对性更强，对腐蚀控制、材料兼容性、洁净度和工艺窗口要求更高	OLED 材料认证和配方能力的重要性更高
产业发展逻辑	存量产能庞大，大尺寸化及稼动率变化影响材料需求	AMOLED 渗透及新产线扩张带来增量需求	LCD 提供需求基本盘，OLED 贡献结构性增量
材料企业竞争要素	规模化生产、成本控制、稳定供应、客户覆盖	配方研发、客户共同开发、快速验证和高端功能化能力	从 LCD 向 OLED 切换，竞争逻辑由“规模供应”进一步向“工艺解决方案”升级

资料来源：开源证券研究所

2.4、 太阳能光伏：电池片产能规模庞大，湿化学品需求维持高位

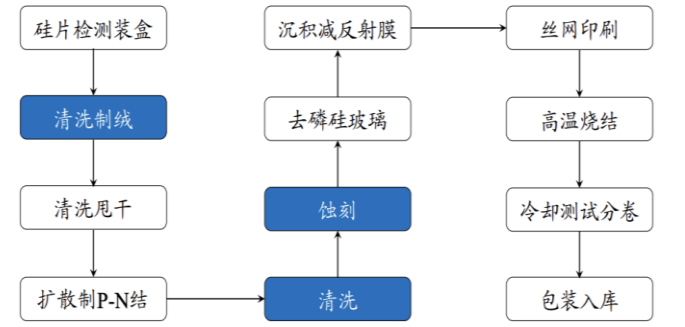
光伏领域是湿电子化学品的重要下游应用之一。电池片制造过程中，湿电子化学品主要用于硅片检测后的清洗制绒、清洗甩干、扩散后 PN 结边缘处理、去磷硅玻璃、蚀刻及后续清洗等环节。其中，制绒环节通过碱性或酸性化学腐蚀在硅片表面

下载日志已记录，仅供内部参考

形成微米级绒面结构，降低光反射率、提高光吸收效率；清洗环节则用于去除金属离子、有机物、颗粒物及工艺残留，保障后续扩散、镀膜和印刷工序的稳定性。

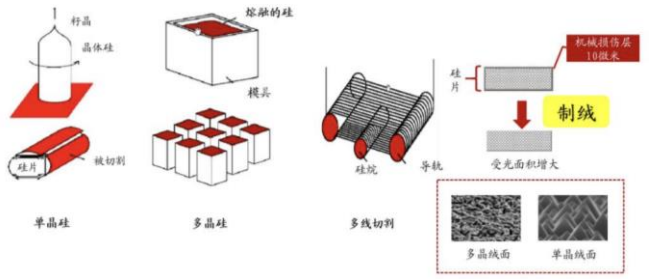
从工艺属性看，光伏用湿电子化学品虽然在纯度等级上通常低于先进集成电路制造要求，但由于光伏电池片出货量大、工艺步骤重复性强，整体用量具备较强规模效应。

图33：湿化学品用于电池片制造的制绒/清洗/蚀刻过程



资料来源：格林达招股说明书、开源证券研究所

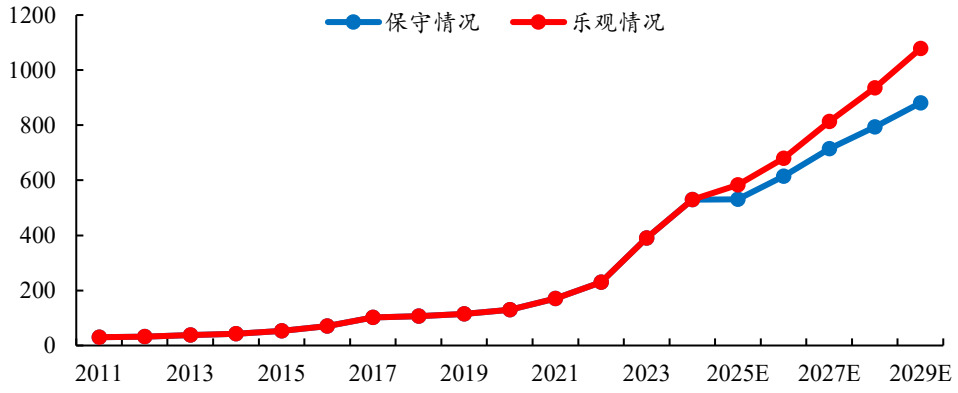
图34：制绒是通过化学腐蚀在硅表面形成绒面结构



资料来源：CEMIA、开源证券研究所

需求端来看，全球光伏新增装机或仍具备一定增长属性。根据中国光伏行业协会的预测，在乐观情形下，全球光伏新增装机规模有望由 2024 年约 530GW 提升至 2030 年约 1,078GW；在保守情形下，2030 年有望达到约 881GW。新增装机增长将继续带动硅片、电池片和组件产出扩张，从而支撑光伏制造环节对湿电子化学品的持续需求。

图35：全球光伏新增装机增长支撑湿化学品高位需求（GW）



数据来源：CPIA、开源证券研究所

2.5、 供给格局：日系欧美厂商把控核心品类，国内厂商加速破局

全球集成电路用湿电子化学品市场集中度较高，海外龙头在超净高纯试剂、功能性配方化学品和 CMP 材料等领域形成较完整的产品体系。根据中国电子材料行业协会数据，欧美、日本、中国台湾、中国大陆和韩国企业在全球市场中的份额分别约为 30%、27%、18%、14%和 10%。欧美代表企业包括巴斯夫、Qnity Electronics（原杜邦电子业务）和 Solstice Advanced Materials（原霍尼韦尔先进材料业务），产

下载日志已记录，仅供内部参考

品覆盖高纯清洗及刻蚀化学品、CMP 材料、蚀刻后及抛光后清洗液、光刻胶去除剂等；韩国企业包括东友精细化工、东进世美肯、Soulbrain 和 ENF Technology 等，主要依托韩国存储和显示面板产业链，在高纯氟化物、刻蚀液、显影液及剥离液等领域形成稳定供应能力。

表4：欧美主要湿化学品厂商聚焦高端品类

所属国家	企业名称	主要业务情况
美国	Qnity Electronics（原杜邦电子业务）	2025 年 11 月由杜邦电子业务分拆成立，产品覆盖 CMP 抛光材料、CMP 后清洗液、蚀刻后残留物清洗液、光刻胶剥离液及先进封装材料等。
美国	Solstice Advanced Materials（原霍尼韦尔先进材料业务）	高纯无机化学品主力，超高纯酸如氢氟酸、盐酸、硫酸，氨水、双氧水等领域具备 G5 级量产能力；高纯有机溶剂（IPA、NMP、丙酮、乙醇）、功能性配方化学品等。 2025 年 10 月完成从霍尼韦尔分拆并独立上市。
德国	巴斯夫 BASF	行业领先供应商，拥有集成电路用湿电子化学品的主要品种，全球领先的湿电子化学品供应商之一，产品覆盖半导体制造用高纯清洗及刻蚀化学品，并布局晶圆减薄、应力释放、硅刻蚀及 3D TSV 等配方型材料。
韩国	东友精细化工 Dongwoo Fine-Chem	日本住友化学在韩国成立的子公司，韩国国内最先开发半导体、TFT-LCD 制造过程中必需的高纯度化学品、蚀刻液
韩国	东进世美肯 Dongjin Semichem	涵盖新型显示（TFT-LCD、OLED 等）领域用所有功能性化学品，如显影液、剥离液、刻蚀液、清洗液等，在平板显示用湿电子化学品领域实力强劲，在铜制程相关化学品上具有垄断优势。
韩国	秀博瑞殷 Soul-brain	湿电子化学品产品线涵盖氢氟酸、BOE 蚀刻液、高选择比磷酸等，是全球领先的高纯氢氟酸供应商之一，在韩国市场占有率高。
韩国	ENF Technology	韩国半导体与显示面板用湿电子化学品的重要供应商，产品涵盖刻蚀液、显影液、稀释剂、剥离液等，2023 年在中国的合资公司被雅克科技收购主要股权。

资料来源：深企投、开源证券研究所

日本企业在全球湿电子化学品市场拥有 27%的市场份额，占据重要市场地位，并在高纯氟化物、超纯清洗材料、光刻配套试剂和 CMP 材料等关键环节形成较强的产品集群。关东化学长期布局半导体高纯化学品及清洗、刻蚀和去胶材料；Stella Chemifa 聚焦超高纯氢氟酸、缓冲氢氟酸等氟化物，主要用于晶圆湿法刻蚀和清洗；三菱瓦斯化学在超纯双氧水、超纯氨水及功能性清洗材料领域具备全球化供应能力；东京应化以光刻胶为核心，同时提供显影液、剥离液等光刻配套材料；富士美则重点布局氧化物、多晶硅、铜及阻挡层等不同体系的 CMP 抛光材料。**据日本经济产业省披露，日本企业在全球光刻胶市场的合计份额约为 90%，围绕光刻胶的功能性湿化学品是日系厂商的强势领域。**

表5：日本主要湿化学品产商：功能性湿化学品形成较强产品集群

企业名称	主要业务情况
住友化学 Sumitomo Chemical	半导体、显示面板等领域用超净高纯化学试剂，在大尺寸晶圆制造应用的湿电子化学品方面具有优势，2024 年中国大陆的合肥、重庆工厂（供应面板蚀刻液、显影液、剥离液等）出售给镇江润晶股份
关东化学 Kanto Chemical	全球半导体用超高纯度化学品的核心供应商，主要是半导体用酸碱类超净高纯试剂（硫酸、氢氟酸、氨水等）和功能性化学品（缓冲蚀刻液、清洗液、显影液等），占有重要份额
Stella Chemifa	核心产品包括超高纯氢氟酸、缓冲氢氟酸和高纯氟化铵，主要应用于半导体晶圆湿法刻蚀、氧化膜去除及清洗。
三菱瓦斯化学	主要产品包括超纯双氧水、超纯氨水及功能性清洗材料，用于半导体晶圆清洗、刻蚀和抛光相关工艺；公司超纯双氧水全球市场份额领先。

下载日志已记录，仅供内部参考

企业名称	主要业务情况
东京应化	以半导体光刻胶为核心，并提供显影液、清洗及剥离等光刻配套材料，产品覆盖成熟制程至先进制程。
富士美	重点布局半导体 CMP 抛光材料，产品覆盖氧化物、多晶硅、铜及铜互连阻挡层等不同材料体系。

资料来源：深企投、开源证券研究所

国内湿电子化学品厂商持续推进产品提纯、品类扩张和客户验证，国产供给已由通用型试剂逐步向 G4/G5 级高纯产品、功能性配方材料和 CMP 材料延伸。根据中国电子材料行业协会数据，中国集成电路用湿电子化学品国产化率稳步提升，但先进制程配套材料和部分高端产品仍由海外企业主导。具体来看，兴福电子、中巨芯、晶瑞电材和江化微持续推进电子级磷酸、硫酸、双氧水及氟化物等高纯产品；安集科技和鼎龙股份重点布局 CMP 抛光液、CMP 后清洗液及功能性清洗材料；上海新阳在电镀液、清洗液及先进封装化学品领域形成较完整布局；格林达则围绕 G5 级 TMAH 显影液推进集成电路客户导入。此外，翰博高新通过参股公司收购韩企在华资产的方式，积极发力功能性湿化学品领域。

表6：国内主要湿化学品厂商：多点开花，积极拓展高端领域

企业	湿电子化学品产品	基地
安集微电子科技(上海)股份有限公司	CMP 抛光液；功能性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液和电镀液系列产品。刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液已经广泛应用于 8 英寸、12 英寸晶圆的集成电路制造领域。相关刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液及 CMP 后清洗液已在 8 英寸、12 英寸晶圆制造领域实现应用。	上海、宁波北仑
湖北鼎龙控股股份有限公司	湿电子化学品业务主要涵盖 CMP 抛光液和 CMP 后清洗液	湖北武汉、仙桃
湖北兴福电子材料股份有限公司	电子级磷酸、电子级硫酸（G5）、电子级双氧水（G5）等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。电子级磷酸产品在国内半导体领域市场占有率第一。公司电子级硫酸、电子级双氧水等产品已达到 G5 等级，并持续推进功能性湿电子化学品和海外客户拓展。	湖北宜昌、上海、重庆
晶瑞电子材料股份有限公司	超净高纯试剂：G5 级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯异丙醇、高纯盐酸、高纯硝酸，其他超净高纯试剂包括 BOE、硝酸、盐酸、TMAH、NMP、异丙醇；功能性材料：显影液、剥膜液、蚀刻液、清洗剂	江苏苏州、江苏如皋、四川眉山、湖北潜江
上海新阳半导体材料股份有限公司	晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂、晶圆制造用清洗剂、CMP 研磨液、半导体封装用电子化学材料	上海、合肥
中巨芯科技股份有限公司	电子级氢氟酸（G5）、电子级硝酸（G5）、电子级硫酸（G5）、电子级盐酸（G4）、电子级氨水（G4）、电子级氟化铵（G4）、缓冲氧化物蚀刻液（G4）、硅蚀刻液（G3）；国内少数能稳定批量供应 12 英寸集成电路制造用电子级氢氟酸，为 12 英寸先进制程稳定批量供应电子级硫酸，为逻辑芯片、存储芯片制造稳定批量供应电子级硝酸的企业	浙江衢州（含浙江凯圣氟化学）、湖北潜江
江阴江化微电子材料股份有限公司	1、酸碱类：硫酸、氨水、过氧化氢、盐酸、硝酸、磷酸、氢氟酸、冰乙酸、氟化铵、胆碱、氢氧化钾、氢氧化钠；2、溶剂：甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、醋酸丁酯、乙二醇、N-甲基吡咯烷酮、丙二醇单甲醚、丙二醇单甲醚醋酸酯；3、功能化学品：蚀刻液、显影液、漂洗液、剥膜液、清洗剂（稀释剂、边胶清洗剂）	无锡江阴、镇江、四川眉山
杭州格林达电子材料股份有限公司	显示面板应用为主，涵盖 TMAH 显影液（G5）、CF 显影液、铝蚀刻液、含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE 蚀刻液）、稀释液、清洗剂等，核心产品为 TMAH 显影液、国内龙头. 公司核心产品 TMAH 显影液已达到 G5 等级，并持续推进集成电路客户验证和产品导入。	杭州、合肥、四川彭山、内蒙古鄂尔多斯
上海飞凯材料科技股份	应用于半导体制造及先进封装领域的湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、	安徽安庆、苏州

下载日志已记录，仅供内部参考

企业	湿电子化学品产品	基地
有限公司	电镀液、CMP 抛光液等	
江苏艾森半导体材料股份有限公司	先进封装用电镀铜基液（高纯硫酸铜）、电镀锡银添加剂、电镀铜添加剂	昆山、南通、东南亚
翰博高新参股公司：合肥芯东进材料科技有限公司	公司通过参股芯东进切入电子材料领域。根据 2026 年公告，芯东进拟收购韩国东进及其子公司设立的 SPV 70%股权，交易标的涉及境内 9 家公司及相关专利。	京、武汉、合肥、成都等

资料来源：深企投、开源证券研究所

地缘政治博弈倒逼晶圆厂供应链安全重构，本土湿电子化学品厂商加速迈入“全面替代与份额提升”的黄金窗口期。受地缘政治及商务部对日两用物项出口管制等事件影响，半导体上游关键材料的供应链断链风险被推至前所未有的高度。

我们认为，以往日系巨头强势的高阶湿电子化学品领域，因“去日化”避险情绪升温，国内主流晶圆厂及封装厂或将大幅加快本土供应商的验证与提量进程。目前，国内头部厂商在 G4-G5 级产品线已具备商业化量产与品类拓展能力，供应链重组的刚性需求不仅显著缩短了验证周期，更推动本土企业从“边缘替代”向“核心主供”跨越，未来市场份额与盈利弹性有望迎来双击。

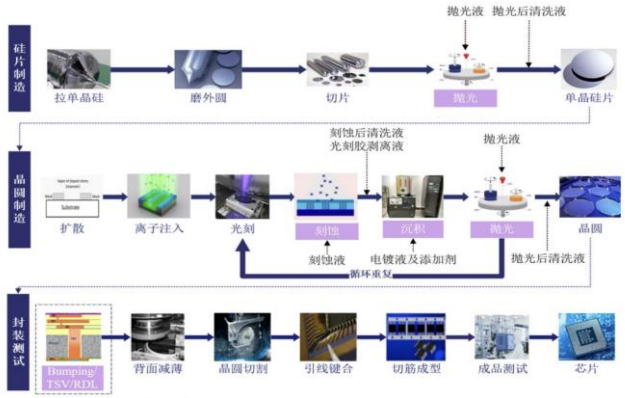
下载日志已记录，仅供内部参考

3、 行业多点开花，优质厂商迎发展机遇

3.1、 安集科技：CMP 材料领军者，功能性湿化学品加速拓展

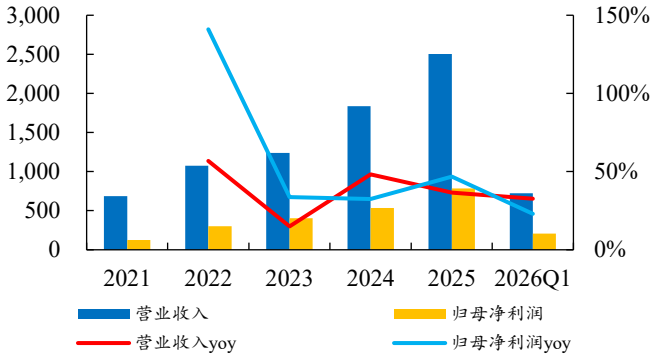
安集科技主营产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域，包括铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、金属栅极抛光液及衬底抛光液、刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液等产品。公司 2025 年实现营收 25.04 亿元/yoy+36.47%，归母净利润 7.84 亿元/yoy+46.85%，其中化学机械抛光液营收 20.40 亿元，功能性湿化学品营收 4.53 亿元，2026 年一季度营收 7.24 亿元/yoy+32.76%，归母净利润 2.08 亿元/yoy+23.01%。

图36：安集科技主要产品在芯片制造及先进封装领域的应用



资料来源：公司年报

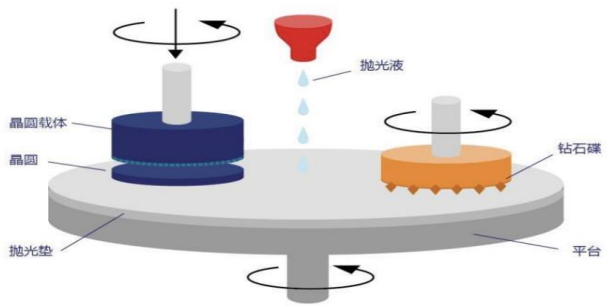
图37：安集科技 2025 年营收利润高增，功能性湿化学品加速放量（百万元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

根据 TECHCET 公开的全球半导体抛光液市场规模测算，最近三年安集科技化学机械抛光液全球市场占有率分别约 8%、11%、13%，逐年稳步提升，已跻身全球化学机械抛光液主流供应厂商行列。公司功能性湿电子化学品已在全球市场崭露头角，[illegible]TECHCET 全球半导体功能性湿电子化学品市场规模测算，2025 年公司功能性湿电子化学品全球市场占有率约为 6%。公司持续投入大量的资金、将重点聚焦在产品创新上，满足下游集成电路制造和先进封装行业全球领先客户的尖端产品应用，已成为国内高端半导体材料行业领域的领先供应商。

图38：CMP 工艺原理图



资料来源：安集科技招股说明书

下载日志已记录，仅供内部参考

3.2、 鼎龙股份：半导体材料多点布局，抛光液/清洗液优势强

鼎龙股份是国内领先的半导体材料平台型公司，重点聚焦包括：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料等，并积极培育多领域增长极。2026 年 1 月，公司披露拟以 6.30 亿元收购皓飞新材 70%股权，切入锂电关键辅材赛道。公司 2025 年实现营收 36.60 亿元/yoy+9.66%，归母净利润 7.20 亿元/yoy+38.32%，其中 CMP 抛光液，清洗液业务营收 2.94 亿元；2026 年一季度营收 10.20 亿元/yoy+23.82%，归母净利润 2.51 亿元/yoy+77.99%。

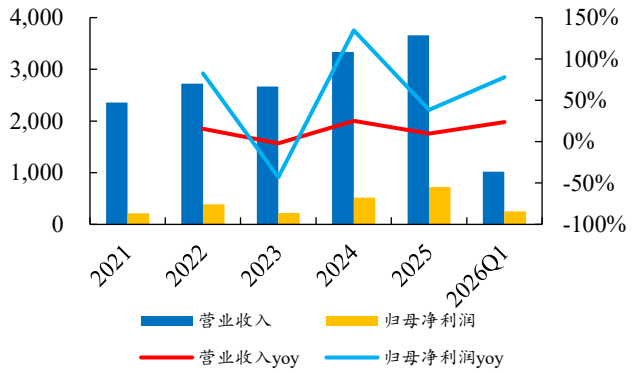
鼎龙股份抛光液产品核心原材料研磨粒子具备自主供应优势，搭载自产四大体系研磨粒子（超纯氧化硅溶胶、高纯氧化硅溶胶、氧化铝、氧化铈）的抛光液产品市场接受度稳步提升，多款产品在客户端持续稳定上量。清洗液方面，铜 CMP 后清洗液产品已在国内多家客户实现增量销售，销售收入稳步提升；其他制程清洗液持续拓展市场，取得稳定销售收入。同时，另有多款清洗液新产品在客户端持续开展技术验证，产品矩阵不断丰富。

图39：鼎龙股份主要产品及应用



资料来源：公司年报

图40：鼎龙股份 2025 年利润增速显著快于收入，2026Q1 弹性延续（百万元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

3.3、 兴福电子：高纯电子化学品平台型企业，电子级磷酸优势突出

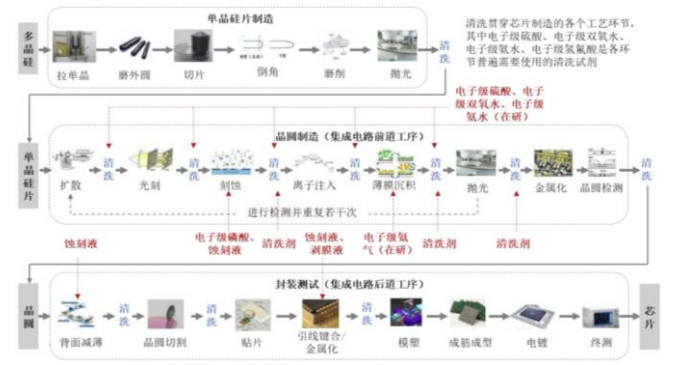
兴福电子主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售，产品主要应用于集成电路领域电子元器件湿法工艺制程的蚀刻、清洗等工艺环节。公司 2025 年实现营收 14.75 亿元/yoy+29.73%，归母净利润 2.07 亿元/yoy+29.69%，其中通用型湿化学品营收 10.05 亿元，功能型湿化学品营收 2.28 亿元；2026 年一季度营收 4.47 亿元/yoy+36.72%，归母净利润 0.64 亿元/yoy+20.22%。

2025 年，公司电子级硫酸回收综合利用项目、硅基前驱体项目、电子级双氧水改扩建等项目顺利投产，电子化学品及配套原材料总体产能规模达到 40.42 万吨/年。集成电路领域销售收入中通用湿电子化学品销量达到 15.92 万吨/yoy+48.07%，功能湿电子化学品销量达到 1.00 万吨/yoy+15.2%。同时公司积极推进国际化业务拓展，着力构建海外供应体系，2025 年实现出口创汇 2,589.08 万美元/yoy+13.78%。与下游客户建立长期合作伙伴关系，得到国内外客户广泛认可，2025 年荣获长江存储最佳协同奖、战略供应商奖以及长鑫科技集团供应商质量奖、华润微电子最佳协同供应商奖等客户荣誉共计 7 项。公司凭借自身产品的优秀性能和稳定供应得到了台积电、SK Hynix、中芯国际、长江存储、华虹集团、长鑫存储、芯联集成、Global foundries、

下载日志已记录，仅供内部参考

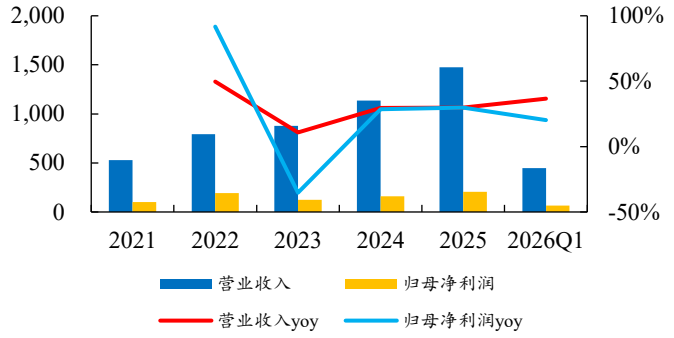
联华电子、德州仪器（成都）等国内外多家知名集成电路行业企业的认可。

图41：兴福电子主要产品在芯片制造中的应用



资料来源：兴福电子股说明书

图42：兴福电子 2025—2026Q1 收入利润保持较快增长（百万元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

3.4、 上海新阳：电子级电镀材料龙头，产能快速扩张

上海新阳在集成电路制造及先进封装用材料领域布局广泛，主要产品包括：晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品、晶圆制造用清洗液系列产品、集成电路制造用高端光刻胶系列产品、晶圆制造用化学机械研磨液系列产品、晶圆制造用蚀刻液系列产品、半导体封装用电子化学材料等。公司 2025 年实现营收 19.37 亿元/yoy+31.28%，归母净利润 3.01 亿元/yoy+71.12%，其中集成电路材料营收 14.79 亿元；2026 年一季度营收 5.77 亿元/yoy+33.05%，归母净利润 1.04 亿元/yoy+102.59%。

2025 年全年上海新阳集成电路材料总销量 2.85 万吨，相较去年同期增长了 45%，其中晶圆制造用化学材料产品销量占比超 80%，合肥新阳扩产项目部分产线已建成并即将进入调试及试生产阶段；上海化学工业区项目稳步推进；上海松江本部 128 亩、年产 50000 吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目已实现年内立项、年内开工，目前进展顺利。随着新产能陆续投产，公司产能规模有望持续释放，支撑未来市场需求增长。公司产品主要通过进口替代进入晶圆制造客户体系，覆盖国内多数半导体封装企业及多家知名晶圆制造企业，已成为国内半导体产业供应链的重要参与者。截至 2025 年底，在国内已投入运行的集成电路生产线中，公司已成为 66 条 12 寸集成电路生产线和 25 条 8 寸集成电路生产线的基准材料，占比分别超过 80%和 50%。

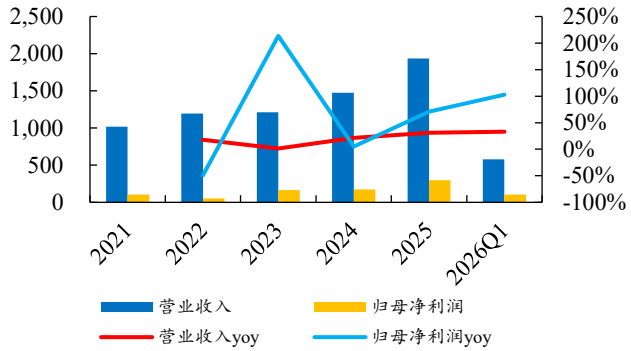
下载日志已记录，仅供内部参考

图43：上海新阳近年来积极扩建项目



资料来源：公司官网

图44：上海新阳 2025 年利润增速快于收入，2026Q1 延续高弹性（百万元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

3.5、 中巨芯-U：高纯湿化学品优势突出，功能性配方加速拓展

中巨芯-U 主要从事电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料业务，湿电子化学品覆盖电子级氢氟酸、硫酸、硝酸、盐酸、氨水以及缓冲氧化物蚀刻液、硅蚀刻液、CMP 后清洗液等产品。2025 年公司实现营收 12.12 亿元/yoy+17.68%，归母净利润-0.17 亿元；2026H1 实现营收 7.99 亿元/yoy+40.98%，归母净利润 0.14 亿元/yoy+72.75%，其中电子湿化学品营收 4.92 亿元/yoy+13.39%，销量 8.62 万吨/yoy+13.98%。

公司高纯湿电子化学品已具备 12 英寸晶圆批量供应能力。电子级氢氟酸、电子级硫酸和电子级硝酸均达到 SEMI G5 等级，并已向中芯国际、华虹集团等客户批量供货。2026H1，公司面向 12 英寸晶圆先进制程推进功能性配方型化学品研发，3 款清洗液、蚀刻液配方产品完成客户端验证及小批量交付。

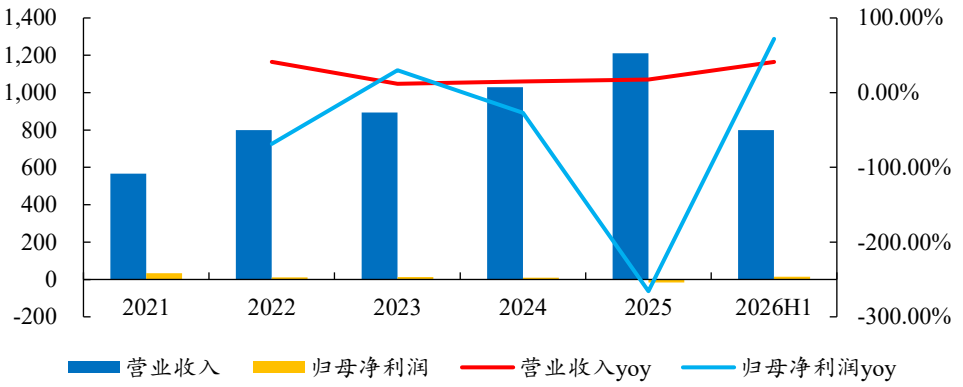
表7：中巨芯-U 主要电子湿化学品产品

类别	产品名称	产品主要用途
电子湿化学品	1.通用电子湿化学品	
	电子级氢氟酸	刻蚀、清洗、玻璃减薄
	电子级硫酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级硝酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级盐酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级氟化铵	缓冲氧化物刻蚀液原料
	电子级氨水	碱性清洗、氟化铵原料
	2、功能电子湿化学品	
	缓冲氧化物刻蚀液	缓释刻蚀
	CMP 后清洗液	CMP 后清洗
	硅刻蚀液	硅刻蚀
	刻蚀后清洗液	刻蚀后清洗

资料来源：公司年报、开源证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

图45：中巨芯-U 2026H1 收入平稳推进，归母净利润增速快于收入（单位：百万元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

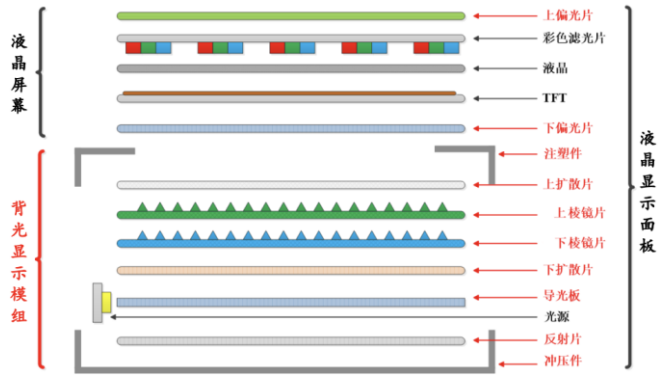
3.6、翰博高新：外延切入湿化学品，打开材料业务第二增长曲线

翰博高新集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，已发展成为半导体显示面板背光显示模组及重要零部件的一站式综合方案提供商。主要产品包括背光显示模组，以及导光板、精密结构件、光学材料等背光显示模组的相关零部件。公司 2025 年实现营收 32.77 亿元/yoy+39.64%，归母净利润-0.97 亿元/yoy+54.94%，其中背光模组营收 25.05 亿，背光显示模组零部件营收 6.20 亿，2026 年一季度营收 9.27 亿元/yoy+27.19%，归母净利润 0.05 亿元/yoy+112.81%，单季度实现扭亏为盈。

公司于 2025 年 12 月参股设立合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”），注册资本 4.4 亿元，其中公司持股有芯东进 45.4545%的股权。芯东进作为收购韩国东进在华资产的主体平台，拟以 1.421 亿美元收购韩国东进及其全资子公司香港东进共同设立的特殊目的公司 70%股权，标的核心资产包含韩国东进境内 9 家目标公司 100%股权及 24 项相关专利。东进世美肯（上海）新材料有限公司已设立并拟作为项目公司归集持有本次收购的资产，芯东进收购韩国东进在华湿电子化学品资产正按收购协议约定有序推进相关交割事项。财务数据方面，9 家目标公司 2024 年实现营业收入 14.73 亿元、净利润 0.93 亿元。2025 年 1-10 月实现营业收入 13.03 亿元、净利润 1.08 亿元。随着公司在湿化学品领域的持续投入，有望依托此业务开辟新的增长通道。

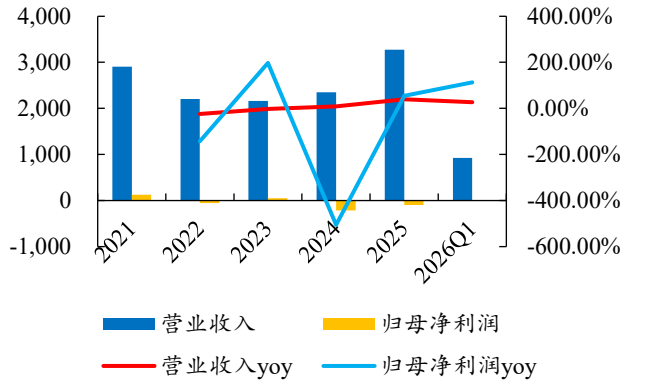
下载日志已记录，仅供内部参考

图46：翰博高新主要产品在液晶显示面板中的构成情况



资料来源：翰博高新《向创业板转板上市报告书》

图47：翰博高新 2026Q1 实现单季度扭亏（百万元）

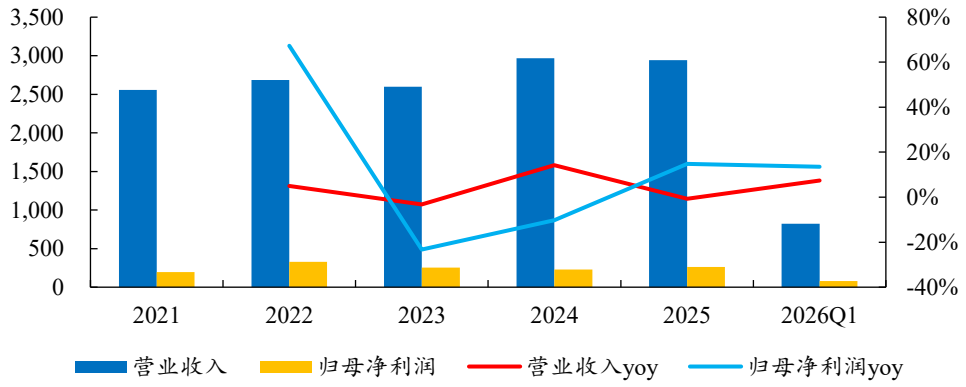


数据来源：Wind、开源证券研究所

3.7、 新化股份：传统化工底盘扎实，电子级化学品业务持续推进

新化股份主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料及其他精细化工产品的生产经营，产品广泛应用于农药、医药、油墨、新能源、涂料等领域；其中有机溶剂系列的主要产品为异丙醇，异丙醇（IPA）是一种重要的化工产品和原料，作为产业链中靠近终端的中间产品，在制药、油墨、涂料、电子清洗等领域均有应用；另外，异丙醇也是工业上比较普遍的溶剂，常用于溶解亲油性物质。公司 2025 年实现营收 29.43 亿元/yoy-0.76%，归母净利润 2.60 亿元/yoy+14.78%，其中有机溶剂业务营收 3.63 亿元，2026 年一季度营收 8.22 亿元/yoy+7.45%，归母净利润 0.81 亿元/yoy+13.55%。

图48：新化股份收入短期平稳（百万元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

公司围绕半导体材料、纳米显示材料、锂电新能源三大方向精准布局，构建“核心引领+协同支撑”的产业生态,并于 2025 年已建成年产两万吨电子级异丙醇项目，2026 年将进入试生产阶段。江苏兴福从动工到试生产用时 15 个月，为 2026 年开拓半导体电子化学品市场奠定坚实基础。新锂想受碳酸锂市场波动影响短期承压。

下载日志已记录，仅供内部参考

表8：新化股份主要产品

产品系列	产品名称	产品简介	用途
脂肪胺	异丙胺	分子式 C3H9N，无色有挥发性的液体；有氨气味；溶于水，呈强碱性；能与水、乙醇和乙醚混溶，属于低碳脂肪胺（C2-C8）类产品	主要用于生产农药、医药、染料和橡胶加工等
	一乙胺	分子式 C2H7N，水溶液，呈碱性，化学性质和氨相似，属于低碳脂肪胺（C2-C8）类产品	主要用于生产农药、化妆品和药品等
	二乙胺	分子式 C4H11N，无色液体，强碱性、具腐蚀性、易挥发、易燃，属于低碳脂肪胺（C2-C8）类产品	主要用于生产医药、染料、橡胶硫化促进剂、杀菌剂、缓蚀剂、浮选剂等
	三乙胺	分子式 C6H15N，有强烈氨臭的无色透明液体，在空气中微发烟，属于低碳脂肪胺（C2-C8）类产品	主要用作溶剂、固化剂、催化剂、阻聚剂、防腐剂，及合成染料等
有机溶剂	异丙醇	分子式 C3H8O，正丙醇的同分异构体，别名二甲基甲醇、2-丙醇，行业中也称作 IPA	是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等
	异丙醚	分子式 C6H14O，又称二异丙醚	动物、植物及矿物性油脂的良好溶剂
合成香料	苯酚类	无色至淡黄色油状液体；在碱性介质中稳定	广泛用于各类香精中，如杂兰、花香、薰衣草、迷迭香等日用香精；可用于食、化妆品，亦可用于食用及烟用香精、美容护理用品
	烯醇类	无色至淡黄色油状液体；香料	广泛应用于日化香精和食用香精，如菠萝、草莓、杏、桃、苹果、甜橙等果香以及胡萝卜和白酒等用香精；柠檬、柑橘和日用香精，用于制作香皂、洗涤剂；是重要的菇类香料
	檀香类	无色至淡黄色油状液体。具有强烈的檀木香气，香气酷似天然的檀香木	广泛用于各类香精，如用于木香型日化香精中，能代替气味纯、丰满的檀香木香效果；多用于皂香水、美容用品、香皂、洗发及家居用品
	醛酮类	无色至淡黄色油状液体；香料	广泛用于日化香精，多用于配制香叶及玫瑰香精，香气者中也调校多；香水配方带来尖而细致的果香，亦用于幻想型香精；食用香精中可用于巴勒杜橙、梅、黄瓜、蜜香等各类果香复方及胶姆糖香精；用于烟用香精、美容护理用品
双氧水及其他	双氧水	分子式 H2O2，无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚	化学工业用作生产硼酸钠、过碳酸钠、过氧乙酸等的原料；酒石酸、维生素等的氧化剂；医药工业用作杀菌剂、消毒剂等；印染工业用作织物的漂白剂等
	二乙基次膦酸铝	白色粉末，不溶于水和有机溶剂，具有高效阻燃、高热稳定性、无卤、低烟、粒径小、分散性好、抗迁移、抗析出性能突出等特点	主要用作热塑性塑料和热固性塑料、纤维及纺织品等产品的阻燃
	GS-80 表面活性剂	分子式 C14H2O2，白色蜡状固体，非离子性产品，属非离子表面活性剂	用于水性系统，包括补料、油墨、胶粘剂、颜料、分散剂、农药和石子选等，功能为降低动态表面张力，改善表面覆盖润湿

资料来源：公司公告、开源证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

3.8、 阿拉丁：科研试剂基础深厚，积极布局电子级材料领域

阿拉丁致力于为科研及工业领域提供高品质试剂产品及专业化服务，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学等领域，同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁（aladdin）”品牌科研试剂和“芯硅谷（i-quip）”品牌实验耗材，主要依托自建电子商务平台开展线上销售，实现产品展示、交易及客户服务的一体化运营。公司 2025 年实现营收 6.96 亿元/yoy+30.39%，归母净利润 1.02 亿元/yoy+3.34%，其中科研试剂业务营收 6.05 亿元，2026 年一季度营收 1.71 亿元/yoy+31.15%，归母净利润 0.29 亿元/yoy+20.31%。

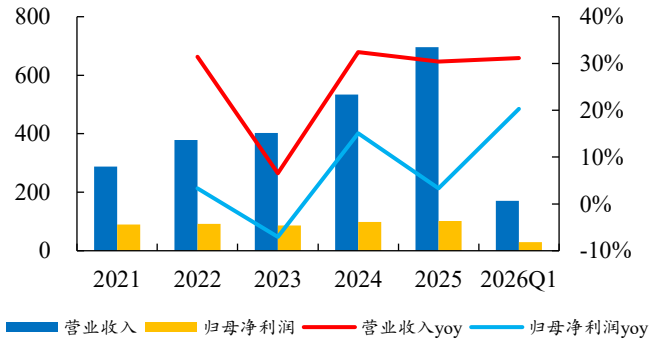
公司紧抓“卡脖子”领域的国产化替代机遇，2025 年，公司进一步加强电子材料及高端功能材料相关试剂布局，并推出覆盖湿电子化学品、基底材料、介电材料、光刻胶原料及前驱体的半导体科研试剂产品组合，主要服务科研和工艺开发场景。

图49：阿拉丁部分用于半导体和微电子的实验室试剂产品



资料来源：公司官网

图50：阿拉丁收入增长较快，但利润弹性仍待释放（百万元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

3.9、 格林达：TMAH 显影液优势突出，集成电路客户导入持续推进

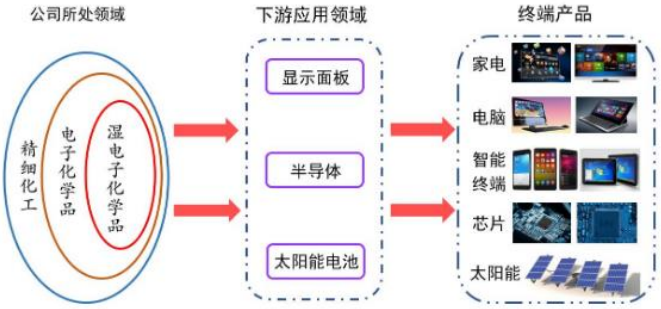
格林达专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售，产品覆盖显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等品类，主要应用于显示面板、半导体及太阳能电池制造过程中的显影、蚀刻和清洗等湿法工艺。公司核心产品为四甲基氢氧化铵显影液，即 TMAH 显影液。公司 2025 年实现营业收入 6.26 亿元/yoy-4.60%，归母净利润 1.23 亿元/yoy-16.23%；2026 年一季度实现营业收入 1.48 亿元/yoy-8.86%，归母净利润 0.29 亿元/yoy-7.88%。

显示面板业务构成公司规模化经营基本盘，客户覆盖与产品矩阵持续拓展。2025 年，四川基地生产的显影液在西南地区客户实现导入及全厂量供，并进入高世代 AMOLED 产线；公司显影液完成广州华星全部测试并形成量供，同时通过 LG Display 直供供应商稽核。除 TMAH 显影液外，公司剥离液、回收液等产品已在部分面板客户形成全厂量供和循环利用闭环，产品结构逐步由单一核心品种向显影、剥离、蚀刻、稀释及清洗等配套湿化学品延伸。

半导体业务已完成项目验收，迈向客户产线导入阶段。公司半导体显影液、稀释液已在功率器件、大硅片等泛半导体领域形成部分稳定供应；此外，公司承担的工信部大规模集成电路用图形显影液研发及产业化验证项目已通过政府整体验收，并完成头部集成电路客户供应商资格审查，后续继续推进产线验证和量供。

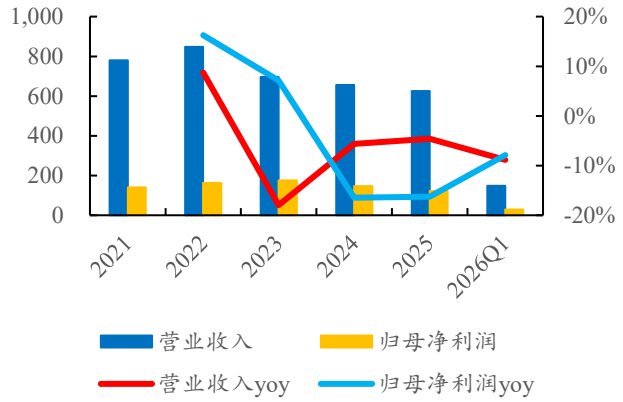
下载日志已记录，仅供内部参考

图51：格林达主要产品应用领域及工艺环节介绍



资料来源：格林达招股书、开源证券研究所

图52：格林达 2025—2026Q1 收入利润短期承压（百万元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

4、 风险提示

下游需求及行业景气修复不及预期风险。半导体材料需求与晶圆厂稼动率、投片量和扩产节奏高度相关，若 AI 以外需求修复偏弱、消费电子复苏不及预期或晶圆厂资本开支放缓，湿电子化学品等材料采购可能低于预期。

湿电子化学品国产替代及客户验证进度不及预期风险。高等级湿电子化学品客户认证周期长，对纯度、金属杂质、颗粒控制和批次稳定性要求高，若国内厂商验证进度、导入比例或量产稳定性不及预期，业绩兑现可能受到影响。

技术迭代及产品升级不及预期风险。先进逻辑、存储高层堆叠和先进封装对清洗、刻蚀、剥离、CMP 后清洗等材料提出更高要求，若企业研发投入、配方迭代或高等级产品开发进展落后于下游工艺变化，可能削弱竞争力。

市场竞争加剧及价格波动风险。海外龙头在高端市场技术和客户资源积累深厚，国内厂商扩产及同质化竞争可能加剧，若产品价格下行或原材料价格、能源成本波动超预期，相关企业盈利能力可能承压。

光伏、显示等下游需求及安全环保监管风险。湿电子化学品同时服务光伏、面板等领域，若相关行业产能出清、装机或面板需求及开工率不及预期，可能影响产品需求；同时化学品生产、运输和环保合规要求较高，若发生安全环保事件或监管趋严，可能影响企业生产经营。

地缘政治与贸易政策变化风险。半导体产业链受国际贸易政策、出口管制及供应链安全因素影响较大，若外部限制升级，可能影响上游原料、关键设备、客户扩产及国产替代节奏。

下载日志已记录，仅供内部参考

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。

因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师声明

本研究报告的署名人员具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，并对内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了署名人员的研究观点，所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。本报告署名人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在－5%～＋5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。
备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数（北交所基准指数为北证 50 指数）、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。		

下载日志已记录，仅供内部参考

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动，过往的业绩表现不应作为其日后表现的预示。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海
地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳
地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京
地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安
地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn